

晶彩科技股份有限公司

114年度年報



中華民國 115 年 5 月 8 日刊印
查詢本年報之網址：<http://mops.twse.com.tw>
公司網址：<http://www.favite.com>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

	發言人	代理發言人
姓名	王子越	蔡淑玲
職稱	執行長	經理
聯絡電話	(03) 554-5988	(03) 554-5988
電子郵件信箱	investor@favite.com	investor@favite.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司及工廠：地址：新竹縣竹北市環北路二段 197 號

電話：(03) 554-5988

台中辦公室：地址：台中市西屯區西屯路三段宏福五巷 8 號

電話：(04) 2460-8158

台南辦公室：地址：台南市新市區三民街 139 號 3 樓

電話：(06) 589-2425

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：台新綜合證券股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號地下一樓

網址：<https://www.tssco.com.tw>

電話：(02) 2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師姓名：方蘇立、葉東輝會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(03) 578-0899

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.favite.com>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	7
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	12
三、公司治理運作情形.....	16
四、簽證會計師公費資訊.....	47
五、更換會計師資訊.....	47
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形.....	47
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	48
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	49
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	49
參、募資情形.....	50
一、資本及股份.....	50
二、公司債辦理情形.....	52
三、特別股辦理情形.....	52
四、海外存託憑證辦理情形.....	52
五、員工認股權憑證辦理情形.....	52
六、限制員工權利新股辦理情形.....	52
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形.....	52
八、資金運用計劃執行情形.....	52
肆、營運概況.....	53
一、業務內容.....	53
二、市場及產銷概況.....	61
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	74
四、環保支出資訊.....	74
五、勞資關係.....	74
六、資通安全管理.....	76
七、重要契約.....	77
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	78
一、財務狀況.....	78
二、合併財務績效分析.....	78
三、現金流量.....	79
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	79
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃.....	80
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項.....	80
七、其他重要事項.....	83
陸、特別記載事項.....	84
一、關係企業相關資料.....	84
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	85
三、其他必要補充說明事項.....	85
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	85

壹、致股東報告書

壹、致股東報告書：誠實面對轉型陣痛，深耕高端技術根基

回顧 114 年度晶彩科技正處於一個關鍵的「技術轉場」與「結構重塑」時期。繼 113 年度本公司成功實現獲利轉正、展現營運韌性後，114 年度本應是乘勝追擊的一年；然而，受全球總體經濟波動、顯示器產業資本支出結構性修正，以及新一代半導體檢測技術驗證週期較長等因素交織影響，本公司 114 年度的財務績效未如預期。年度結算呈現經營虧損，營收規模較前一年度出現顯著回落。面對這份未能達成股東期待的成績單，經營團隊深感責任重大，在此向全體股東致以最誠摯的歉意。

身為高階光學檢測設備的研發者，我們深知在科技產業的長河中，一時的財務起伏往往是技術更迭的先行指標。114 年度的虧損本質上是晶彩科技邁向高端半導體與先進封裝市場的「戰略性陣痛」。在傳統顯示器產能擴張放緩的寒冬，我們並未選擇盲目守成或透過削減研發費用來美化短期帳面，反而選擇了最艱難但最具前瞻性的路徑：加大對 AI 智能化平台、2.5D/3D 先進封裝檢測技術的投資。

我們堅信技術的深度決定了企業生存的寬度。近年研發布局並非為了爭奪單一項目的終點，而是為了在 AI 先進封裝這場無限賽局中，建立具備高度適應力的技術基石。透過對核心檢量測技術的深耕，我們力求在產業每一次的技術浪潮下，都能成為協助客戶重新定義良率極限的穩定守護者。這份「不退縮、不守成」的意志，已在 114 年末看到曙光。隨著 12 月營收展現出近十倍的強勁反彈，且單月自結已實現獲利，這不僅是營運的轉折，更是市場對我們技術轉型價值的初步認可。

展望 115 年，我們將以「如履薄冰」的審慎態度，維持「務實精進」的執行力。我們不追求虛華的營收擴張，而是聚焦於技術資源的積累與客戶價值的落實。晶彩科技正以更精實的體質，回歸科技製造業品質守護者的本質，穩健前行。

貳、114 年度營業結果與財務深度分析：景氣修正下的戰略抉擇

一、顯示器產業景氣修正對營收之衝擊

114 年度全球顯示面板產業面臨嚴峻的週期性修正。受終端消費性電子需求疲軟及主要大廠產能稼動率調降影響，客戶對既有產線的採購意願趨於嚴苛，導致傳統 AOI 設備的訂單認列進度推遲。

- **營收縮減之結構成因**：114 年度合併營收約為新台幣 4.59 億元（較 113 年度的 6.67 億元衰退約 31%）。營收規模的下降，導致固定成本分攤比例上升，是造成本年度經營虧損的主要外部因素。

- **財務緩衝與體質：**儘管獲利受壓，公司始終維持極高的流動比率與速動比率，財務槓桿控制於安全範疇，確保研發投資具備充足的後盾，無懼短期資金流動性風險。

二、研發費用 (R&D) 的逆勢增長：未來利潤的超前部署

在經營虧損的壓力下，本公司 114 年度的研發支出比例不減反增。這並非盲目的資源擴張，而是基於對 2.5D/3D 先進封裝市場高度成長性與技術門檻所達成的戰略共識。我們深知唯有在技術轉場期保持領先，才能在產業長期的無限賽局中，持續保有定義卓越品質的資格。

本年度研發投入之戰略深度，主要體現在以下三大面向：

- **技術替代之研發壁壘：**半導體檢測設備的技術複雜度與穩定性要求遠高於傳統顯示器等級。為開發足以應對 2 μ m 細微線路 (RDL) 的高階 AOI 檢測技術，本公司投入了大量的資源於光學路徑模擬元件、高頻影像處理解析演算法，以及低震動精密傳動系統之開發。這類基礎研發的投入，是確保本公司跨越半導體門檻、實現技術代差的必要基石。
- **高精度先進封裝量測 (Metrology) 之持續深耕：**隨著異質整合技術的演進，客戶對設備的需求已由單純的瑕疵檢出，提升至亞微米級的數據精確度。本公司持續在高精度量測設備領域注資，研發針對 Die Location (晶片位置)、Overlay (重疊對位) 以及 3D 量測等關鍵製程之計量技術。透過整合高解析度感測組件與即時反饋補償系統，我們致力於為先進封裝製程提供更為精準的數值指標，協助客戶在微縮製程中實現良率最大化。
- **驗證週期的戰略性延遲與展望：**半導體高端設備進入一線封測廠或載板大廠，需經過極為漫長嚴苛的驗證期。114 年度的研發投入雖然在財務面造成了即時壓力，但隨著各項產品陸續進入驗證收尾階段，預計將於未來幾年逐步轉化為實質營收。這是一場與時間賽跑、以技術厚度為本的戰略馬拉松，我們正全力衝刺，期盼在通過驗證後，能儘快為公司注入成長動能。

參、核心技術進化：AI 與 AOI/Metrology 的深度融合

在自動化光學檢測領域，晶彩科技正致力於重新定義「檢測」的維度。我們認為，未來的競爭力不在於發現缺陷，而在於具備診斷生產製程的能力。

一、Horus 智能化平台的技術演進

本公司自主研發的 Horus 智能化光學檢測平台，在 114 年度完成了跨世代的升級。

- **多維光學路徑整合：**透過新一代照明技術，Horus 平台能在同一掃描週期內捕捉不同材質的細微特徵，大幅減少了二次掃描的需求。

- **自適應圖像處理解決方案：**針對生產環境中的光影變幻與雜訊干擾，Horus 導入了新型 CNN 模組，實現了 Sub-pixel 的瑕疵定位精準度。

二、AI 驅動下 AOI 與 Metrology 雙軌技術之深度進化

晶彩科技在研發戰略上採用了 Inspection（檢查）與 Metrology（量測）雙軸並行的策略，並全面導入深度學習演算法，使設備由傳統的規則判斷轉化為具備「智慧認知」的感測平台。

- **AI 賦能 AOI：**實現真實瑕疵（Real Defect）的極致檢出在先進封裝製程中，環境雜訊與複雜線路背景常導致傳統 AOI 產生大量誤報。本公司透過 AI 智能影像強化與分類技術，不僅追求極致的掃描速度，更大幅提升了 Real Defect 的辨識精度。AI 演算法能自動過濾偽瑕疵（False Alarm），精準鎖定微米級的異物、斷路或線寬異常，解決客戶「看得到、看得準」的剛性需求，有效降低後端複判的人力依賴。
- **AI 強化 Metrology：**定義亞微米級的計量新基準隨製程微縮至極限，關鍵尺寸（CD）與重疊對位（Overlay）的精確數據化已成為良率控制的核心。本公司將 AI 應用於量測設備的特徵判斷與座標擬合中，透過 AI 特徵識別（Feature Extraction），設備能針對結構模糊或對比度低之目標物進行精確的特徵定位與判讀，消除人工設定的誤差波動。在對位精度比瑕疵檢測更為關鍵的 2.5D/3D 封裝中，這種結合 AI 的高精度量測技術，已成為晶彩科技在高端市場中異軍突起的戰略利器。

三、從「瑕疵檢出」進化到「良率診斷」

面對製造業勞工短缺與高昂的複判成本，晶彩科技的 AI 系統已實現了「自動分類與根本原因分析（RCA）」。

- **解決缺工痛點：**透過 AI 自動瑕疵複判（ADC），我們協助客戶減少了超過 70% 的複判人力投入，有效解決了生產線上的勞動力瓶頸。
- **良率增益：**系統能即時將檢測數據回傳至製造執行系統（MES），透過大數據分析瑕疵的分佈趨勢，幫助製程工程師快速定位設備異常，將檢測功能由後端的品質過濾推前至前端的良率管理。

肆、產業新機會：2.5D/3D 先進封裝戰略布局

隨著摩爾定律邁向物理極限，AI 晶片與高效能運算對算力的渴求，已將半導體產業推向了「先進封裝」的新賽道。這對具備大幅面檢測技術儲備的晶彩科技而言，是前所未有的藍海市場。

一、AI 晶片帶動的封裝技術革命：2.5D 先進封裝與 3D IC 封裝

隨生成式 AI 帶動運算模組的高度整合，2.5D 封裝 3D 封裝已成為決定運算性能的核心製程。

- **2.5D 先進封裝**：透過矽中介層處理器與高頻寬記憶體緊密相連，其重佈線層線路下探至 2 μ m 甚至以下。
- **3D 垂直堆疊**：晶片間的垂直互連要求極其苛刻的平坦度與對位精準度，這對光學量測提出了近乎物理極限的挑戰。

二、晶彩科技在 Wafer Form 與 Panel Form 雙軌布局的獨特性

晶彩科技具備極其獨特的競爭優勢，即我們同時掌握了處理 Wafer-level（晶圓級）與 Panel-level（面板級）載體的能力：

- **Wafer Form 高階檢測平台**：針對 12 吋半導體晶圓載體，本公司開發之高速智能化檢測系統已順利獲得指標性客戶採用。透過專利光學設計與自適應演算法，針對晶圓表面極其細微的結構異常與形貌特徵，提供兼具產速與亞微米級精度的全自動解決方案。我們將檢測重點鎖定於先進製程中對於品質零容忍的關鍵工序，透過對微觀結構缺陷的即時捕捉，協助客戶在複雜的異質整合過程中建立穩定的良率監控屏障；不僅滿足了嚴苛的工業等級需求，更展現了本公司在半導體檢量測市場的技术延展力。
- **Panel Form (FOPLP) 布局**：FOPLP（面板級扇外型封裝）被視為降低封裝成本、提升產能的次世代關鍵技術。憑藉本公司過去在處理大尺寸玻璃基板（LCD/OLED）累積的深厚機構設計與光學處理經驗，我們在 FOPLP 領域具備得天獨厚的亞微米級精度與大面積超高速算力之整合能力。
 - **大場域處理能力**：傳統晶圓檢測機難以應對面板級載體，而晶彩科技在處理大幅面、高變形率載體上擁有豐富深厚的專業經驗。
 - **2 μ m RDL 細微線路檢測技術**：針對先進封裝中日益精細的重佈線層（RDL），本公司研發出獨創的特殊光學路徑與成像系統。該技術能在複雜的背景干擾下，實現對微細導線瑕疵的精準定位與捕捉。這不僅代表了本公司在光學解析力上的突破，更已成為晶彩科技在高端封裝檢量測領域中，難以被輕易跨越的技術護城河。
 - **面板製程跨域延伸之超高速算力**：不同於傳統檢測設備往往在速度與準確性之間取捨，晶彩科技核心競爭力在於將過去在面板產業深耕多年、處理大幅面基板所累積的超高速影像並行處理算力，完美移植至先進封裝領域。
 - **藉由自主研發的硬體加速架構與高效能算法**，我們能夠在維持亞微米級檢測精度的同時，處理海量的影像數據，達成極高的產出率（Throughput）。這種「兼具極致速度與絕對準確性」的技術特性，使本公司設備能在客戶追求產能極大化的連續生產環境中，提供即時且無遺漏的品質守護。
- **Die Location 量測的領先技術**：

在先進封裝製程中，晶片被貼裝於載板上的精準位置直接決定了後續電路接點的成功率。我們開發出的高精度量測演算法，提供了亞微米級（Sub-micron）的對位精度分析。目前正與知名載板與封裝客戶進行深度驗證測試，預期在通過驗證後，將成為公司營收增長的新引擎。

伍、新世代顯示技術：Micro LED/OLED 的守候與機會

儘管新顯示技術的放量速度受限於成本與製程難度，但晶彩科技始終本著「守候與引領」的態度，在市場爆發前夕建立完整的技術護城河。

一、Micro LED 市場潛力與全製程方案

Micro LED 因其具備高亮度、長壽命、低能耗及可拼接性，被公認為顯示技術的終極形式。

- **巨量轉移後的檢測屏障：**Micro LED 的核心痛點在於數千萬顆微米級 LED 晶粒的「巨量轉移」。晶彩科技研發出了一系列高精度、高速檢測設備，針對轉移後的晶粒缺失、極性錯誤及位置偏差，提供自動化的篩選與修正建議。
- **全產線布局：**從上游 Epiwafer 品質檢查，到中游巨量轉移檢量測，再到下游面板模組拼接後的導線檢測，晶彩科技已建立實績。隨兩岸大廠新產能建置，我們預期 Micro LED 項目將在未來貢獻穩健營收。

二、Micro OLED 在 AR/VR 市場的潛力

Micro OLED（矽基 OLED）結合了半導體與 OLED 技術，是 AR/VR 及穿戴式裝置的理想選擇。

- **高解析度挑戰：**由於像素尺寸縮減至微米等級，傳統檢測機台已難以應對。晶彩科技成功利用半導體 Wafer AOI 的經驗，開發出針對 Micro OLED 前段製程（如 Inline/Mask AOI）的產品線。
- **技術護城河：**本公司已於 113-114 年獲得指標性客戶的設備訂單。隨著 Micro OLED 在市場新產能的建置，預計逐年可對營收產生貢獻。

陸、115 年度經營方針與長期展望：務實精進，如履薄冰

展望 115 年度，晶彩科技不對市場復甦做過度樂觀的假設。全球地緣政治風險、供應鏈重組及產業循環波動依然是不容忽視的變數。

一、經營方針：務實精進，追求質變

本公司將 115 年度定義為「價值轉化年」。我們的年度口號是：「務實精進，技術立本」。

1. **驗證轉訂單：**全速推進在 114 年投入驗證的高端半導體與先進封裝檢量測機台，力求縮短結案週期，儘快轉化為實質營收。

2. 售後服務與升級 (Aftermarket Service)：隨本公司既有設備裝機量 (Installed Base) 持續成長，我們將強化售後服務、軟體演算法升級與 AI 模組改裝服務，這類高黏著度的營業收入性也將成為穩定的基石。

3. 產業升級驅動：持續關注電子紙、高階顯示器、載板等利基市場的自動化需求，利用現有 AI 核心技術快速延伸，開發多元化產品線。

二、長期展望：技術積累是唯一的解答

晶彩科技始終秉持「技術創新，品質穩定，效率提升，客戶滿意」的政策。我們深知，在科技設備產業，沒有永遠的坦途。114 年度的經營虧損是一面鏡子，照出了我們在面對單一產業景氣過度依賴的風險，但也映出了我們轉型高端市場的決心。

- 我們對 115 年的營運展望保持審慎。團隊將以「如履薄冰」的心態控管各項營運成本，不隨意擴張低效益的業務，而是將每一分資源都精確鎖定在具備長期競爭優勢的技術研發上。
- 經營團隊的首要目標是儘快恢復獲利。透過 114 年積累的技術專利與市場驗證，我們有信心在這一波 AI 與先進封裝的大勢中，為股東創造長期且穩定的價值。

感謝各位股東在晶彩科技最關鍵的轉型時刻，依然選擇信任並伴隨我們。我們將持續精進，不負所託。

敬祝各位股東：身體健康，萬事如意。

晶彩科技股份有限公司



董事長：陳永華



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人

1. 董事及監察人資料

115年3月31日單位:股

職稱	國籍或註册地	姓名	性別/年齡	選(就)/任日期	任期	初次選任日期	選任時		現在	配偶、未成年子女或在持有股份	利用他人名義持有股份	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例(%)						股數	持股比例(%)	職稱	
董事長兼總經理	中華民國	陳永華	男/ 61至70歲	114.5.29	3年	93.07.01	1,900,813	2.40%	1,900,813	-	-	Faviet Limited 董事長 晶華科技(股)公司董事長 德而信微電子(股)公司董事長	-	-	-	(註5)	
董事	中華民國	由田新技	-	114.5.29	3年	107.03.21	10,747,272	13.60%	8,971,272	-	-	清華大學物理系 大同工學院事業經營研究所 晶彩科技(股)董事長	-	-	-	-	
董事	中華民國	由田新技	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣科技大學工業管理系 由田新技(股)公司自控技術部本部分管副總	-	-	-	-	-	
董事	中華民國	王人傑	男/ 41至50歲	-	-	-	-	-	-	-	政治大學法律系 由田新技(股)公司法務主管	-	-	-	-	-	
董事	中華民國	由田新技	-	114.5.29	3年	107.03.21	10,747,272	13.60%	8,971,272	-	-	由田新技(股)公司法務主管	-	-	-	-	
董事	中華民國	代表人： 許智超	男/ 41至50歲	-	-	-	-	-	-	-	大同工學院機械工程學系 捷申精密科技(股)公司董事長	-	-	-	-	-	
董事	中華民國	林宗仁	男/ 61至70歲	114.5.29	3年	111.06.24	1,394,000	1.76%	1,394,000	2,000	0.00%	清華大學物理系 厚錫科技(股)公司總經理	-	-	-	-	
董事	中華民國	單希基	男/ 61至70歲	114.5.29	3年	114.5.29	-	-	-	-	-	清華大學工業工程研究所 王淑珍保險經紀人事務所負責人	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	王淑珍	女/ 61至70歲	114.5.29	3年	114.5.29	-	-	-	-	-	誠品聯合會計師事務所合夥會計師 北合所所長	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	嚴海華	女/ 41至50歲	114.5.29	3年	114.5.29	-	-	-	-	-	國立中央大學會計系研究所 誠品聯合會計師事務所合夥會計師 新北分所所長	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	李培政	男/ 51至60歲	114.5.29	3年	108.06.12	-	-	-	-	-	元智大學資訊管理學系教授 威揚科技(股)公司董事	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	沈錦文	男/ 61至70歲	114.5.29	3年	111.06.24	-	-	-	-	-	美國杜蘭大學商管碩士 缺業科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-	
董事	中華民國	由田新技	-	111.06.24	3年	107.03.21	11,379,272	14.39%	8,971,272	不適用	不適用	實踐大學企業創新創業管理研究所肄業 由田新技(股)公司董事	-	-	-	(註4)	
董事	中華民國	代表人： 張文杰	男/ 51至60歲	-	-	-	-	-	-	-	-	由田新技(股)公司總經理	-	-	-	-	
董事	中華民國	葉勝發	男/ 71至80歲	111.06.24	3年	111.06.24	300,000	0.38%	1,000	不適用	不適用	美國西康大學商研所碩士 光陽光電(股)公司董事長	-	-	-	(註2)	
董事	中華民國	由田新技	-	111.06.24	3年	107.03.21	11,379,272	14.39%	8,971,272	不適用	不適用	由田新技(股)公司董事	-	-	-	(註4)	
獨立董事	中華民國	代表人： 林芳隆	男/ 61至70歲	-	-	-	-	-	-	-	-	中山大學企業管理研究所 由田新技(股)公司董事	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	曾祥器	男/ 61至70歲	111.06.24	3年	98.09.23	-	-	-	不適用	不適用	清華大學物理系教授 中原大學物理系教授	-	-	-	(註4)	
獨立董事	中華民國	羅志平	男/ 51至60歲	111.06.24	3年	111.06.24	-	-	-	不適用	不適用	輔仁大學電子工程學系 東折企業(股)公司總經理 威東新技術有限公司副總經理	-	-	-	(註4)	

註1：由田新技(股)公司董事長、由田新技(股)公司總經理、科吉凱亞(股)公司董事長、雷福投資(股)公司董事長、雷福投資(股)公司監察人、京華超音波(股)公司董事長、天地綠科技(股)公司董事長、廣化科技(股)公司董事長、鼎元光電(股)公司獨立董事。
 註2：夏目智能(股)公司董事長、光陽光電(股)公司董事長、雷福投資(股)公司董事長、雷福投資(股)公司監察人。
 註3：由田新技(股)公司董事長、雷福投資(股)公司董事長、雷福投資(股)公司監察人。
 註4：由田新技(股)公司董事長、雷福投資(股)公司董事長、雷福投資(股)公司監察人。
 註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

(1) 董事長兼任總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。
 (2) 本公司設有審計委員會，除明定其職權外，亦可健全及監督董事會之管理機能，同時本公司獨立董事席次44.44%，除加強監督與制衡之機制外，亦可降低因董事長兼總經理而造成權力集中，失其客觀性及有效監督等情事。

2. 法人股東之主要股東：

115 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
由田新技(股)公司	匯豐託管坎布里亞新興股東收益 E T F (3.00%)、匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶(2.51%)、鄒嘉駿(1.85%)、志聖工業股份有限公司(1.83%)、葉惠德(1.69%)、曾繼輝(1.67%)、瑞泉文嘉股份有限公司(1.67%)、三葉股份有限公司(1.48%)、隆華群資投資股份有限公司 (1.33%)、花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶(1.23%)

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

115 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東
志聖工業股份有限公司	均豪精密工業股份有限公司(12.73%)
瑞泉文嘉股份有限公司	鄒嘉駿(99.40%)
三葉股份有限公司	葉丁源(99.32%)
隆華群資投資股份有限公司	劉素華(37.50%)

4. 董事專業資格及董事獨立性資訊揭露：

姓名/職稱	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳永華/董事長		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，為本公司創辦人，目前擔任晶彩科技(股)公司董事長暨總經理，未有公司法第 30 條各款情事之一。	(註 1)	-
由田新技(股)公司/董事 代表人：王人傑		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任由田新技(股)公司自控技術部本部分管副總，未有公司法第 30 條各款情事之一。	(註 1)	-
由田新技(股)公司/董事 代表人：許智超		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任由田新技(股)公司法務主管，未有公司法第 30 條各款情事之一。	(註 1)	-
單希基/董事		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任厚錦科技(股)公司總經理，未有公司法第 30 條各款情事之一。	(註 1)	-
林宏仁/董事		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任捷坤精密科技(股)公司董事長，未有公司法第 30 條各款情事之一。	(註 1)	-
王淑珍/獨立董事		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任王淑珍保險經紀人事務所負責人，未有公司法第 30 條各款情事之一。	(註 1)	-

姓名/職稱	條件 專業資格與經驗	獨立性 情形 (註1)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
李詩政/獨立董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任元智大學資訊管理學系教授，具財務會計專業，未有公司法第30條各款情事之一。	(註1)	-
沈錫文/獨立董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾經擔任力成科技(股)公司資深副總經理，未有公司法第30條各款情事之一。	(註1)	1
蘇興華/獨立董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任誠品聯合會計師事務所合夥會計師，未有公司法第30條各款情事之一。	(註1)	-

註1：董事會獨立性：本公司設置獨立董事4人，佔董事會4/9。

本公司董事會符合下列獨立性條件：

- (1) 董事會成員非為本公司及其子公司高階管理人員之家庭成員。
- (2) 董事會成員擔任本公司或本公司高階管理人員之顧問及其關係人，僅董事陳永華一人。
- (3) 董事會成員為本公司重要客戶或供應商之關係人僅董事王人傑及董事許智超。
- (4) 董事會成員未與本公司或本公司高階管理人員有個人服務合約。
- (5) 董事會成員非為收受本公司重大捐贈之非營利組織關係人。
- (6) 董事會成員於過去3年非為本公司外部審計會計師或人員。
- (7) 董事會成員無董事會認為其不能被視為獨立之其他利益衝突。
- (8) 董事會成員非為會符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定具二親等以內親屬關係。
- (9) 獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定。

5. 董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

B. 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司為達成董事多元背景的目標，於民國114年股東會董事改選後，女性董事從未設置增加為二名，雖尚未達董事席次的三分之一，但我們將在未來提名過程中，優先考慮女性候選人，並積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

管理目標	達成情形
獨立董事不得少於二人且席次不得少於董事席次五分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化核心能力 姓名/職稱	基本組成						產業經驗							
	國籍	兼任本公司員工	性別	年齡			營運能力	會計及財務分析	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				41-50	51-60	61-70								
陳永華/董事長	中華民國	✓	男	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
由田新技(股)公司 / 董事代表人： 王人傑	中華民國	-	男	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
由田新技(股)公司 / 董事代表人： 許智超	中華民國	-	男	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林宏仁/董事	中華民國	-	男	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
單希基/董事	中華民國	-	男	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王淑珍/獨立董事	中華民國	-	女	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蘇興華/獨立董事	中華民國	-	女	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李詩政/獨立董事	中華民國	-	男	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
沈錫文/獨立董事	中華民國	-	男	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

目前本屆 9 位董事成員即已具有產業界以及學術界等專業背景，在經營管理、領導決策、產業知識、學術及財務金融等領域各有專長，相關資訊亦揭露於本公司網站。董事成員包含 1 位具有員工身份之董事占比為 11%，4 位獨立董事占比為 44%，其年資分別為 3 年以下、3 年以下、3-9 年及 3-9 年，董事年齡 41-50 歲以下有 3 位，51-60 歲有 1 位，61-70 歲以上有 5 位。截至 114 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第 7 頁-董事資料)。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年3月31日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或以二親等以內關係之經理人		備註
					股數	持股份率(%)	股數	持股份率(%)	股數	持股份率(%)			職稱	姓名	
董事長兼總經理	中華民國	陳永華	男	93.07.01	1,900,813	2.40%	-	-	-	-	清華大學物理系 大同工學院事業經營研究所 晶彩科技(股)董事長	FaviteLimited 董事長 晶隼科技(股)公司董事長 億而得微電子(股)公司董事	-	-	(註1)
執行長	中華民國	王子越	女	114.09.01	80,155	0.10%	-	-	-	-	Master of Business Administration, Saint Leo University. 晶彩科技(股)公司副總經理	-	-	-	-
研發副總經理	中華民國	葉東益	男	114.09.01	17	0.00%	-	-	-	-	台灣大學應用力學研究所 晶彩科技(股)公司協理	-	-	-	-
財務會計及公司治理主管	中華民國	曾彩薇	女	112.02.24	-	-	-	-	-	-	逢甲大學會計學系研究所 勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理	-	-	-	(註3)
公司治理主管	中華民國	郭龍章	男	112.05.05	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用	英國公立威爾斯大學財務會計 研究所 虹光精密工業股份有限公司財 務部經理暨集團財務長	-	-	-	(註2)

註1：總經理或相當職務者(最高經理人等)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

- (1) 董事長兼任總經理能使董事會更掌握公司營運狀況，且扁平化管理能使決策執行更具效率。惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選。
- (2) 本公司設有審計委員會，除明定其職權外，亦可健全及監督董事會之管理機能，同時本公司獨立董事共佔總董事席次 44.44%，除加強監督與制衡之機制外，亦可降低因董事長兼總經理而造成權力集中，失其客觀性及有效監督等情事。

註2：因公司職務輪調，已於 114/05/09 卸任。

註3：於 114/05/09 就任公司治理主管。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於1,000,000 元	陳永華、由田新技(股)公司代表人：王人傑、由田新技(股)公司代表人：許智超、林宏仁、單希基、由田新技(股)公司代表人：林芳隆、由田新技(股)公司代表人：張文杰、葉勝發、蘇興華、李詩政、沈錫文、曾祥器、羅志平	王人傑、由田新技(股)公司代表人：許智超、林宏仁、單希基、由田新技(股)公司代表人：林芳隆、由田新技(股)公司代表人：張文杰、葉勝發、蘇興華、李詩政、沈錫文、曾祥器、羅志平	由田新技(股)公司代表人：王人傑、由田新技(股)公司代表人：許智超、林宏仁、單希基、由田新技(股)公司代表人：林芳隆、由田新技(股)公司代表人：張文杰、葉勝發、蘇興華、李詩政、沈錫文、曾祥器、羅志平	由田新技(股)公司代表人：王人傑、由田新技(股)公司代表人：許智超、林宏仁、單希基、由田新技(股)公司代表人：林芳隆、由田新技(股)公司代表人：張文杰、葉勝發、蘇興華、李詩政、沈錫文、曾祥器、羅志平
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	陳永華	陳永華
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	14	14	14	14

(二) 總經理及副總經理之酬金

114年12月31日 單位：新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 (%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	本公司	股票金額	本公司	財務報告內所有公司			
董事長兼總經理	陳永華															
執行長	王子越	9,946	9,946	281	281	1,653	1,653	-	-	-	-	(14.09)	(14.09)		-	
研發副總經理	葉東益															

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	陳永華、王子越、葉東益	陳永華、王子越、葉東益
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3	3

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114年12月31日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長兼總經理	陳永華	-	-	-	-
	執行長	王子越(註1)				
	研發副總經理	葉東益(註1)				
	公司治理主管	郭龍章(註2)				
	財務會計及 公司治理主管	曾彩薇(註3)				

註1：執行長王子越、研發副總經理葉東益於114年9月1日新任。

註2：公司治理主管郭龍章先生已於114年5月9日卸任。

註3：財務會計及公司治理主管曾彩薇於114年5月9日新任公司治理主管。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

職稱	年度	本公司				合併報表所有公司			
		113年度		114年度		113年度		114年度	
		總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金		2,972	5.45%	1,794	(2.13)%	2,972	5.45%	1,794	(2.13)%
總經理及副總經理酬金		8,336	15.30%	11,880	(14.09)%	8,336	15.30%	11,880	(14.09)%
稅後純益		54,492		(84,299)		54,492		(84,299)	

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 本公司於民國100年08月26日經董事會決議設置「薪資報酬委員會」，主要職責為定期檢討董事及經理人之績效表現與薪資報酬政策、制度、標準及結構，並綜合考量公司營運成果、產業環境、公司發展策略及未來風險因素，提出具體建議供董事會審議後決議，以確保薪酬制度之合理性與公司治理之健全性。
- (2) 董事酬金包括車馬費及公司獲利提撥之董事酬勞。車馬費依出席會議次數支付；董事酬勞則依公司章程第十九條規定，年度如有獲利，由董事會決議提撥不超過當年度稅前獲利之百分之二作為董事酬勞，並依董事之參與程度、具體貢獻及同業水準核給，以兼顧激勵效果與公司財務健全。
- (3) 獨立董事酬金以固定報酬為原則，114年度每月領取固定報酬新臺幣3萬元，並依實際出席會議情形支給出席費。

(4) 經理人酬金組合包括固定薪資、績效獎金及員工酬勞等。公司依市場薪酬水準、職務權責範圍、個人績效表現及對公司營運目標之貢獻程度給付合理酬金，以達到吸引及留任優秀人才之目的。

另依公司章程第十九條規定，年度如有獲利，將提撥不低於百分之十為員工酬勞，其中員工酬勞提撥總額之中，不低於百分之二十將分派予基層員工，依員工之績效評估結果及貢獻度進行分配，以共享營運成果並強化團隊向心力，激勵員工持續提昇績效並追求公司長期發展。

(5) 董事及經理人薪酬均經薪資報酬委員會及董事會審慎審核，其訂定原則兼顧公司長期營運績效、永續發展策略及潛在風險承擔，並配合產業景氣與經營環境變化適時檢討調整。此機制有助於平衡短期營運成果與長期風險控管，維護股東權益，確保公司治理與酬金政策之透明與公正性。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

上屆董事任期：111年6月24日至114年6月23日

本屆董事任期：114年5月29日至117年5月28日

114年度董事會開會7次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	陳永華	7	0	100%	
董事	由田新技(股)公司 代表人：王人傑	3	0	100%	114.05.29 新任
董事	由田新技(股)公司 代表人：許智超	3	0	100%	114.05.29 新任
董事	林宏仁	7	0	100%	
董事	單希基	3	0	100%	114.05.29 新任
董事	由田新技(股)公司 代表人：張文杰	4	0	100%	114.05.29 卸任
董事	由田新技(股)公司 代表人：林芳隆	4	0	100%	114.05.29 卸任
董事	葉勝發	1	3	25%	114.05.29 卸任
獨立董事	王淑珍	3	0	100%	114.05.29 新任
獨立董事	沈錫文	6	1	86%	
獨立董事	李詩政	7	0	100%	
獨立董事	蘇興華	3	0	100%	114.05.29 新任
獨立董事	曾祥器	4	0	100%	114.05.29 卸任
獨立董事	羅志平	4	0	100%	114.05.29 卸任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第14條之3所列事項：參閱董事會重要決議事項。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期/屆次	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	決議情形
114.01.17. 第九屆 第十六次	陳永華	113 年度經理人年終獎金發放案	與董事自身 有利害關係	不參與表決	其餘出席董事 決議照案 通過
114.08.08. 第十屆 第二次	陳永華、 由田新技 (股)公司 代表人： 王人傑、 由田新技 (股)公司 代表人： 許智超、 林宏仁	113 年度董事酬勞發放案案。			
	陳永華	113 年經理人員工酬勞發放案			
	陳永華	114 年度經理人年度調薪計畫案			
115.01.30. 第十屆 第四次	陳永華	114 年度經理人年終獎金發放案			
	王淑珍、 蘇興華、 李詩政、 沈錫文	訂定董事酬勞及報酬給付辦法			

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形。

本公司董事會暨功能性委員會績效評估執行情形說明如下：

(一) 評估週期：每年定期執行內部董事會暨功能性委員會績效評估

(二) 評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

(三) 評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估。

(四) 評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、審計委員會及薪資報酬委員會內部自評。

(五) 評估內容：

1. 董事會績效評估：

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 董事會決策品質。
- (3) 董事會組成與結構。
- (4) 董事的選任及持續進修。
- (5) 內部控制。

2. 董事會成員績效評估：

- (1) 公司目標與任務之掌握。
- (2) 董事職責認知。
- (3) 對公司營運之參與程度。
- (4) 內部關係經營與溝通。
- (5) 董事之專業及持續進修。
- (6) 內部控制。

3. 功能性委員會績效評估：

- (1) 對公司營運之參與程度。

- (2) 功能性委員會職責認知。
- (3) 提升功能性委員會決策品質。
- (4) 功能性委員會組成及成員選任。
- (5) 內部控制。

(六) 績效評估結果：評估結果提報 115.01.30.董事會報告，114 年度董事會之績效評估結果為「佳」，董事會成員之績效評估結果為「佳」，審計委員會、薪資報酬委員會之績效評估結果為「優良」。績效評估之結果將運用於個別董事或功能性委員會委員薪資報酬及提名續任之參考。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一) 設置功能性委員會：為健全監督功能及強化管理機能，本公司已分別設置審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會等功能性委員會。
- (二) 加強公司治理：本公司以訂定公司治理實務守則、風險管理政策及程序，及董事會績效評估辦法，並依法令規定揭露公司治理資訊。

(二) 審計委員會運作情形資訊

1. 本委員會由全體獨立董事組成，成員專業資格與經驗請參閱本年報第 8~10 頁獨立董事專業資格與經驗及獨立性情形料。
2. 本委員會協助董事會履行對公司會計、審計、財務報告和內部控制實踐的質量和完整性的監督，本委員會之職權事項如下：
 - 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
 - 內部控制制度有效性之考核。
 - 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - 涉及董事自身利害關係之事項。
 - 重大之資產或衍生性商品交易。
 - 重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - 財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
 - 其他公司或主管機關規定之重大事項。
3. 審計委員會運作情形：

上屆委員任期：111 年 6 月 24 日至 114 年 6 月 23 日
本屆委員任期：114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日
最近年度(114 年度)審計委員會開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	王淑珍	2	0	100%	114.05.29 新任
獨立董事	沈錫文	5	1	83%	
獨立董事	李詩政	6	0	100%	
獨立董事	蘇興華	2	0	100%	114.05.29 新任
獨立董事	曾祥器	4	0	100%	114.05.29 卸任
獨立董事	羅志平	4	0	100%	114.05.29 卸任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
114.01.17. 第一屆 第十五次	1. 增訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。	所有獨立董事對議案均一致通過
114.03.07. 第一屆 第十六次	1. 本公司 113 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 本公司 113 年度盈餘分派案。 3. 本公司 113 年度營業報告書及 114 年度營業計劃案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 5. 本公司 114 年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。 6. 本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案。	
114.04.18. 第一屆 第十七次	1. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。	
114.05.09. 第一屆 第十八次	1. 本公司 114 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司公司治理主管異動案。 3. 本公司簽證會計師提供預先核准非確信服務之清單。	
114.08.08. 第二屆 第一次	1. 本公司 114 年第二季合併財務報表。 2. 本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。 3. 董事會授權沈錫文獨立董事管理稽核單位及簽核稽核報告案。 4. 修訂「薪工循環」內部控制制度及「內稽實施細則-薪工循環」部分條文案。 5. 修訂「核決權限表」部分條文案。 6. 修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」部分條文案。	
114.11.07. 第二屆 第二次	1. 114 年第三季合併財務報表。 2. 115 年度稽核計畫案。 3. 指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案。 4. 修訂「核決權限表」部分條文案。	

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1. 獨立董事透過每季審計委員會或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，針對財務報表查核或核閱結果及相關法令遵循事項進行溝通討論，若遇有重大事項時得隨時召集討論。

2. 本公司稽核主管均定期呈交稽核報告予獨立董事審查，獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集討論。

(1) 獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期/屆次	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
114.03.07. 第一屆第十六次 (單獨會議)	法規變動報告 民國 113 年度個體財務報表暨合併財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應	獨立董事無建議
114.05.09. 第一屆第十八次 (單獨會議)	法規變動報告 民國 114 年第一季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應	獨立董事無建議
114.08.08. 第二屆第一次 (單獨會議)	法規變動報告 民國 114 年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應	獨立董事無建議
114.11.07. 第二屆第二次 (單獨會議)	法規變動報告 民國 114 年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應	獨立董事無建議

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

(2) 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期/屆次	溝通事項摘要	獨立董事建議及公司處理情形
114.01.17. 第一屆第十五次 (單獨會議)	內部稽核業務報告。	獨立董事無建議
114.03.07. 第一屆第十六次 (單獨會議)	內部稽核業務報告。 113 年度內部控制制度聲明書案。	獨立董事無建議
114.04.18. 第一屆第十七次 (單獨會議)	內部稽核業務報告。	獨立董事無建議
114.05.09. 第一屆第十八次 (單獨會議)	內部稽核業務報告。	獨立董事無建議
114.08.08. 第二屆第一次 (單獨會議)	內部稽核業務報告。	獨立董事無建議
114.11.07. 第二屆第二次 (單獨會議)	內部稽核業務報告。 115 年度稽核計畫案。	獨立董事無建議

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異 情形及原因																
	是	否	摘要說明																	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，投資人並可於本公司網站公司治理專區查詢公司治理相關規章。	尚無重大差異																
二、公司股權結構及股東權益																				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司設置發言人、代理發言人及委託專業股務代理機構處理股東建議或疑義等事宜。	尚無重大差異																
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司依據股務代理機構辦理停止過戶時所提供之股東名冊確實掌握對於主要股東、董事及經理人持股情形。另對內部人(董事、經理人及持有股份超過百分之十以上之股東)所持股權之變動情形，按月申報主管機關指定之公開資訊觀測站。	尚無重大差異																
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業間業務往來，均依相關之內部控制制度與法令規定執行與控管。	尚無重大差異																
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		<p>本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，並強化內線交易之防範。</p> <p>對新任董事、經理人及受僱人則於上任後1個月內提供教育宣導，本公司於民國 114 年，對現任董事計 8 人次，進行防範內線交易相關宣導共計 2 次。</p> <p>自民國 111 年起，本公司將【防範內線交易及誠信經營】納入全體同仁必修課程，其課程內容涵蓋證券交易法之內線交易相關規範、責任與案例及誠信經營的重要性等，並將課程簡報、作業程序存放於公共資料夾，供所有同仁隨時查閱。</p> <p>此外，本公司亦定期指定不同部門的同仁參加防範內線交易及誠信經營相關之內部、外部教育訓練(含誠信經營法規、法律實務、進階財務管理、內線交易及內部控制等課程)，以強化同仁對法令的認知與遵循，114 年度相關教育訓練總授課時數為 58 小時，共 36 人次參與相關課程，詳細受訓紀錄如下表。</p> <table border="1" data-bbox="651 1406 1289 1697"> <thead> <tr> <th>民國 114 年課程名稱</th> <th>完訓人次</th> <th>訓練總時數</th> <th>完訓率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>誠信經營暨防範內線交易</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>114 年度防範內線交易宣導會(視訊)</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td>6</td> <td>18</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	民國 114 年課程名稱	完訓人次	訓練總時數	完訓率	誠信經營暨防範內線交易	25	25	100%	114 年度防範內線交易宣導會(視訊)	5	15	100%	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	6	18	100%	尚無重大差異
民國 114 年課程名稱	完訓人次	訓練總時數	完訓率																	
誠信經營暨防範內線交易	25	25	100%																	
114 年度防範內線交易宣導會(視訊)	5	15	100%																	
114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	6	18	100%																	
三、董事會之組成及職責																				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		請參閱本年報第 8~10 頁董事會多元化及獨立性之說明。	尚無重大差異																
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，另本公司於 114/11/7 成立永續發展委員會；其他功能性委員會，將依公司營運狀況評估設立必要性。	尚無重大差異																

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務 守則差異 情形及原因	
	是	否		摘要說明
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司業已訂定「董事會績效評估辦法」，並依該辦法於民國 115 年 1 月間完成民國 114 年度董事會績效評估作業，且將該績效評估結果運用做為董事會討論及決議 114 年度董事酬勞之參考依據，未來改選董事時亦將以該績效評估結果作為提名續任之參考。	尚無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性，並向董事會報告評估結果。審計委員會於民國 115 年 3 月 6 日將最近一次評估結果提報董事會。 本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，要求會計師每年提供「獨立聲明書」及會計師事務所之審計品質指標 (AQIs) 外，另參酌品質管制準則 1 號、會計師法第 47 條及會計師職業道德規範第 10 號公報訂定製作「會計師獨立性及適任性評估表」，針對可能影響獨立性項目逐一評估，經評估會計師與本公司除簽證及財稅案件費用外，無其他財務利益及業務關係，符合獨立性及適任性之要求。	尚無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，主要業務為以下： 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 協助董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 獨立董事資格之適法性審核。 7. 辦理董事異動相關事宜。 8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	尚無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		公司網站已設置利害關係人專區，提供與利害關係人溝通與聯繫的專屬信箱，對於企業社會責任相關議題，如果有任何疑問、建議或申訴事項，皆可以藉由此信箱進行良好之互動。	尚無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。	尚無重大差異
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司已架設網站，揭露財務業務及公司治理相關資訊。	尚無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		本公司已架設網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露；落實發言人制度；不定期參加外部機構舉辦之法人說明會，法人說明會資料均已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	尚無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司配合法令規定，於規定期限前公告並申報年度及各季財務報告與各月份營運情形。	尚無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		<p>1. 員工權益：公司依照勞基法及人事規章之規定，保障員工合法權益，並定期召開勞資會議，協調勞資關係。</p> <p>2. 僱員關懷：本公司秉持友善職場環境之理念徵才及留才，塑造良好之工作環境，除設有職工福利委員會，依法提撥職工福利金外，另依法提撥員工退休金，加保員工團體意外險並安排員工健康檢查，以謀求員工最大福利。</p> <p>3. 投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外關係之溝通，除定期更新公司營運結果，並指派專人依據法令規定於公開資訊觀測站中揭露本公司資訊。</p> <p>4. 供應商關係：藉由管理階層間的不定期交流與主要供應商、承攬商共同合作，強化夥伴關係，追求更好的績效。</p> <p>5. 利害關係人之權利：本公司與員工、往來客戶、供應商及承攬商等均保持良好之溝通管道，並尊重且維護其合法之權益。利害關係人得隨時提供意見與公司溝通，公司均非常重視各項意見，以作為未來各項工作之參考依據。</p> <p>6. 董事及監察人進修之情形：本公司已設置審計委員會取代監察人職能。本公司董事均具專業背景，且依法令規定參加進修課程，並取得證明文件。各項進修明細請參考附註1說明。</p> <p>7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：業依法訂定各項內部規章，進行各種風險管理及評估。</p> <p>8. 客戶政策之執行情形：本公司設有專責單位處理客戶申訴，妥善處理客戶問題，並與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>9. 本公司已購置董事責任保險，並揭露於公開資訊觀測站。</p>	尚無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司每年皆針對近期公司治理評鑑結果及最近年度發布之公司治理評鑑指標，逐一檢視尚未符合得分標準之指標，安排改善時程並已完成改善大部分未達標項目。				

註1：董事及監察人進修之情形如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	陳永華	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
法人董事 代表人	許智超	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		114/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3
法人董事 代表人	王人傑	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		114/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3
董事	單希基	114/10/31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/11/07	社團法人中華公司治理協會	公司治理主管與董事會評估發展	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
		114/11/13	社團法人中華公司治理協會	ESG 風險與機會對財務衝擊之影響	3
		114/12/08	財團法人台北金融研究發展基金會	生成式 AI 的商業價值與數位風險	3
董事	林宏仁	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3
		114/09/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
獨立董事	王淑珍	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		114/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3
獨立董事	李詩政	114/05/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
		114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
獨立董事	沈錫文	114/04/11	台灣董事學會	公司治理升級:打造人才競爭力新局	3
		114/08/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位金融大革命:穩定幣的原理與區塊鏈虛擬貨幣資產的發展趨勢	3
		114/10/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
獨立董事	蘇興華	114/09/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
		114/11/13	社團法人中華公司治理協會	ESG 風險與機會對財務衝擊之影響	3

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形。

本公司由全體獨立董事 4 名組成薪資報酬委員會，負責訂定並定期評估公司整體薪資報酬政策；訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬。

1. 薪資報酬委員會成員資料如下表：

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事 (召集人)	王淑珍	請參閱本年報第 8~9 頁 獨立董事專業資格與經驗及獨立性情形		-
獨立董事	蘇興華			-
獨立董事	李詩政			-
獨立董事	沈錫文			1
獨立董事	曾祥器			-
獨立董事	羅志平			-

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2) 上屆委員任期：111 年 6 月 24 日至 114 年 6 月 23 日

本屆委員任期：114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日

最近年度(114年度)薪資報酬委員會開會2次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	王淑珍	1	-	100%	114.05.29 改選後新任
委員	蘇興華	1	-	100%	114.05.29 改選後新任
委員	李詩政	3	-	100%	
委員	沈錫文	3	-	100%	
委員	曾祥器	2	-	100%	114.05.29 改選後卸任
委員	羅志平	2	-	100%	114.05.29 改選後卸任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- 三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/1/17	1. 審議本公司 113 年度經理人年終獎金計畫案	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果處理
114/3/7	1. 審議本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提列金額及發放方式案	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果處理
114/8/8	1. 審議本公司 113 年度董事酬勞發放案 2. 審議本公司 113 年度經理人員工酬勞發放案 3. 審議本公司經理人晉升案 4. 審議本公司 114 年度經理人年度調薪計畫案	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果處理

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權管理層處理，及董事會督導情形？	✓		尚無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		尚無重大差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司主要為機械設備組裝及測試，並未產生有害物質及廢水，故並無通過國際實務守則驗證，與永續發展實務守則無尚無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓	<p>「垃圾減量、回收再利用」為核心目標，所使用包裝材料優先選擇可回收再利用之材質，藉以降低資源消耗及避免二次污染之產生，持續推動營運過程的綠色化與永續化。</p> <p>本公司持續投入資源於節能改善與綠色製程導入，114 年度共投入新臺幣 5,995 仟元進行設備汰換及能源監控系統優化，整體節能效益如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 年節電量：170,012 度 ● 年減碳效益：80.59 公噸 <p>主要執行情形如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 能源管理措施：汰換老舊或效能不佳之供電設備，包括高壓電變壓器與分離式變頻冷氣機，提升整體能源效率。 ● 能源監控系統：建立能源使用監測機制，針對總公司與廠區（如冰水主機、空壓機等）進行使用量分析與時段控管，進一步降低電力使用量達 134,000 度，適度導入再生能源，以減少或降低營運碳足跡並提升能源使用效率。 	尚無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來之潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓	<p>本公司已將氣候變遷對企業經營構成長期潛在風險與挑戰，並已納入公司治理架構中，持續透過以下作法進行管控與因應：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 健全治理架構：於董事會轄下設置永續發展委員會，定期追蹤氣候行動與減碳目標之執行進度，確保相關策略與公司整體發展目標一致。 ● 強化策略韌性：進行氣候情境分析，評估不同升溫情境下之營運與財務影響，據以滾動修正中長期策略與資源配置。 ● 完善風險控管機制：將氣候風險納入企業風險管理體系，並建立供應鏈備援措施，以提升面對極端氣候事件之營運持續能力。 <p>本公司深知氣候變遷與環境永續為全球重要議題，已制訂「節能減碳與資源管理政策」，以系統化方式逐年改善主要作法如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 落實減碳目標：推動全範疇 (Scope 1~3) 溫室氣體 	尚無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、溫室氣體排放物總重量，並制定溫室氣體管理之政策？	✓	<p>本公司已統計過去兩年溫室氣體排放量、溫室氣體排放物總重量，並制定溫室氣體管理之政策，以減少用水或其他廢棄物管理之政策。</p>	尚無重大差異

執行情形(註 1)

摘要說明

年度	項目	總公司 (GJ)	台中 辦公室 (GJ)	台南 辦公室 (GJ)	合計 (GJ)
	再生能源	-	-	-	-
	總能源	4,102.7530	15.4008	135.5137	4,253.6674
	再生能源百分比	-	-	-	-

● 本公司貫徹防治污染、節約能源以減低對環境的影響，並保證以安全與環保無虞的方式來處理任何廢棄物，關於清除乙級清物，避免產生一般事業廢棄物委託有甲級事業廢棄物處理資格之環保公司代為清除環境安全，並制定每年減量0.5%廢棄物。過去兩年廢棄物總重量如下：

年度	總公司	台中 辦公室	台南 辦公室	廢棄物 總重量
113 年度	18.10	0.74	23.73	42.57
	非有害事業廢棄物 產出 (噸)	0	0	0
114 年度	19.6	1.8	19.9	41.30
	非有害事業廢棄物 產出 (噸)	0	0	0

本公司落實飲水安全與節水管理，每三個月進行濾芯更換作業，以確保飲用水品質並透過內部宣導及加裝自閉式水龍頭，並制定每年減量1%用水量。過去兩年用水量如下：

年度	總公司	台中 辦公室	台南 辦公室	總用水量
113 年度	4,350	116	203	5,822
114 年度	5,408	41	181	5,630

推動項目

是

否

推動項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>● 紙張使用減量：逐步推動表單電子化與線上簽核流程，每年平均減少紙張使用約 50,000 張，使用量降低逾 20%，以減少資源消耗並提升作業效率。</p> <p>本公司將持續依據 ISO 14001 與國際永續報告準則（ISSB、TCFD 等），深化氣候績效管理與資訊揭露，以實踐綠色經營與企業永續責任。</p>	
四、社會議題			
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓	<p>本公司遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國工商企業與人權指導原則》及《國際勞工組織核心公約》等國際人權基準，並恪遵我國《國際勞工組織核心公約》、性別平等、個人資料保護及其他相關法令，制定人權政策，作為保障員工、供應商、承攬商、客戶及其他利害關係人基本人權之依循準則。本公司由永續發展推動小組-企業社會責任組持續發展人權管理相關事宜，將人權議題納入持續精進管理措施。</p> <p>本公司為履行保障人權之責任，依據營運活動及內部管理風險辨識及揭露之風險評估、預防與減緩職權調查流程，透過追蹤與揭發之負面影響、禁止童工、禁止強迫勞動、禁止不平等對待及非法侵害員工身心健康等管理議題。</p> <p>本公司人權盡職調查對象，包括營運活動及價值鏈中之勞工、員工、強迫勞動、童工、職業性騷擾、非法侵害員工身心健康等管理議題。</p> <p>一、 風險辨識：就公司營運活動及價值鏈中之勞工、員工、強迫勞動、童工、職業性騷擾、非法侵害員工身心健康等管理議題，進行風險評估，並與工會、職工代表、人權專家、律師、NGO 等利益相關方進行溝通，以確保風險評估之完整性及準確性。</p> <p>二、 風險評估：依據人權風險評估工具，對各項人權風險進行評估，並根據風險之嚴重性、發生可能性及影響程度，制定預防及減緩措施。</p> <p>三、 預防及減緩措施：針對辨識之人權風險，訂定相應</p>	尚無重大差異

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>六、維護職場所安全與健康：本公司依職業安全衛生相關法令及 ISO 45001 職安衛管理系統架構，持續推動危害辨識、風險評估及緊急應變演習，並由專責人員追蹤環境健康政策及相關管理措施之執行情形，並向董事會報告人權保障機制。</p> <p>七、發生涉人權侵害之事件，本公司將依既有申訴、調查及處理機制辦理，並就事件原因、改善措施及補救作為進行檢討，以低度衝擊類似事件再度發生。重大違反人權事件，114 年度人權相關訓練，場次共 42 場，參與人數 135 人，總時數 411.5 小時。</p> <p>八、供應商業社會責任自評問卷，與「實地訪查」，逐步建立人權管理機制；具體流程如下：</p> <p>一、風險辨識 (Identify) — CSR 自評問卷要求前十大及重要物料供應商填寫「企業社會責任自評問卷」，評核標準包括勞動契約、禁止使用童工及強迫勞動、落實性別平等與多元共榮等基礎條款。</p> <p>二、評估與驗證 (Assess) — 實地訪查與分級針對對問卷對象中，供應商自我評估尚未落實的項目，規劃啟動實地訪查 (Site Audit) 或第三方稽核，並逐步建立分級制度。</p> <p>三、減緩與改善 (Mitigate) — 輔導與追蹤優良廠商：給予優先採購權或列為長期夥伴。風險廠商：要求提出改善計畫，並於期限內進行複評。若涉及重大違規 (如僱用童工)，將終止合作關係。</p> <p>本公司重視員工權益與福祉，訂有合理薪酬制度及多元員工福利措施，並將經營績效及經營成果反映於員工薪酬，以落實成果共享及人才留任。依本公司章程規</p>	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		尚無重大差異

推動項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	<p>是</p> <p>摘要說明</p> <p>公司為提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育，並提供各項福利及激勵措施。公司並提供各項福利及激勵措施，包括：(1) 員工安全與健康檢查：公司每年提供員工安全與健康檢查，並提供必要之醫療服務。(2) 員工安全與健康培訓：公司每年提供員工安全與健康培訓，並提供必要之教育資源。(3) 員工安全與健康設施：公司每年提供員工安全與健康設施，並提供必要之設備及器材。(4) 員工安全與健康保險：公司每年提供員工安全與健康保險，並提供必要之保險服務。(5) 員工安全與健康諮詢：公司每年提供員工安全與健康諮詢，並提供必要之諮詢服務。(6) 員工安全與健康活動：公司每年提供員工安全與健康活動，並提供必要之活動經費。(7) 員工安全與健康獎勵：公司每年提供員工安全與健康獎勵，並提供必要之獎勵經費。(8) 員工安全與健康改善：公司每年提供員工安全與健康改善，並提供必要之改善經費。(9) 員工安全與健康研究：公司每年提供員工安全與健康研究，並提供必要之研究經費。(10) 員工安全與健康合作：公司每年提供員工安全與健康合作，並提供必要之合作經費。</p>	<p>否</p>	尚無重大差異

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	<p>摘要說明</p> <p>令規定之員工年度健康檢查，透過駐廠職護及職醫定期駐點服務，追蹤與評估員工健康狀況，提供健康諮詢及必要之健康建議，並不定期舉辦運動促進、健康促進活動及心理健康課程，強化員工身心健康保護。</p> <p>114年度職業災害統計：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 職業災害事件數：0件 • 罹災人數：0人，占員工總人數比率：0% • 為持續維持良好職業安全衛生績效，本公司持續強化職業災害預防教育與宣導，精進風險評估及現場稽核機制，並落實各項危害辨識與預防管理作業，以維持零職災目標。 <p>114年火警事故統計：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 火警事件數：0件 • 罹災人數：0人，估員工總人數比率：0% <p>為提升防災應變能力及，本公司每半年實施自衛消防編組教育訓練及演練，並於每年11月辦理全廠消防設備檢查，檢查結果送消防主管機關備查，持續強化消防安全管理，確保送消人員安全及維護員工人身安全。</p> <p>本公司視人才發展為企業永續經營之重要基礎，訂有「教育訓練發展策略、組織需求及員工職能」，並每年編列教育訓練預算，依據公司發展目標及有效之人才培育機制，制定良好之職涯發展計畫及有效之人才培育機制。</p> <p>具體措施包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依職涯發展需求，安排部門專業訓練及領導管理面向，以協助員工提升專業能力與工作效能。 2. 鼓勵員工透過不同部門或職務間之輪調與交流，拓展實務經驗及跨領域視野，強化跨部門協作能力並培育潛在儲備幹部。 3. 針對新進同仁，規劃個別化訓練計畫，內容包括新人訓練、制度與企業文化認識、職務技能訓練、資深同仁帶領及階段性評估，以協助其儘速融入團隊並適應工作環境。 4. 提供外部訓練費用補助，鼓勵員工參與專業研討會、 	尚無重大差異	

推動項目	執行情形(註 1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>基於前述評估結果，本公司採行多項相應措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在社區環境守護方面，於114年4月及5月分別辦理台南七股沙洲淨灘及新竹頭前溪淨溪活動，號召員工及眷屬共同參與，總計投入45人次，服務時數114小時，以實際行動守護在地海岸與河岸環境。 • 在地教育關懷方面，針對總部所在地竹北市泰和里弱勢學生，透過里辦公處辦理助學金捐贈，年度累計捐贈金額為新臺幣2萬元，以支持弱勢家庭學童受教權益。 • 在社區共好與環境清潔方面，於114年12月與泰和里合作辦理掃街活動，由17位員工與里民共同參與，累計志工服務時數25.5小時，共檢拾81.7公斤垃圾，藉由實際參與社區環境維護，減輕營運據點可能造成之環境負荷疑慮，並深化社區互動與睦鄰關係。未來本公司將持續關注營運對社區之影響，滾動檢討社區參與措施及投入方式，以落實企業社會責任並促進社區共好發展。 			

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊:

項目	執行情形
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>本公司董事會為氣候相關風險與機會管理之最高監督單位。於 114 年 11 月 7 日前，由永續發展推動小組負責日常執行、跨部門協調及定期彙報。為進一步強化永續治理架構，本公司董事會於 114 年 11 月 7 日通過「擬設置永續發展委員會暨訂定永續發展委員會組織規程案」，並委任第一屆委員；嗣於 114 年 12 月 30 日召開第一屆第一次會議，正式啟動運作。管理階層則由永續長統籌，結合相關權責單位，依 TCFD 架構逐步推動溫室氣體盤查、節能改善、氣候風險辨識及低碳管理等工作，以強化公司對氣候議題之治理基礎與應變能力。詳情請參閱《2025 年永續報告書》第二章。</p>
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>本公司參考 TCFD 架構，辨識氣候相關實體風險與轉型風險，並依影響時程區分為短期(1-3 年)、中期(3-5 年)及長期(5 年以上)，評估其對業務、策略及財務之可能影響。</p> <p>短期而言，極端氣候事件如暴雨、停電、高溫等，可能對營運據點、設備運作、物流及交期造成影響，進而增加營運中斷風險與短期成本負擔。中期而言，隨碳費制度、節能法規、客戶碳揭露要求及供應鏈管理規範逐步趨嚴，公司可能面臨合規成本上升，但亦可藉由提前進行盤查、節能改善及管理建置，提升營運效率與客戶合作優勢。長期而言，若國際市場持續朝低碳供應鏈與綠色製造發展，公司需持續強化低碳管理能力與產品設計調整，惟亦有助於拓展新市場、提升品牌信任及強化長期競爭力。</p> <p>相關內容請參閱《2025 年度永續報告書》第二章〈循光綠意前行〉2-1 節「氣候變遷因應行動」。</p>
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>本公司評估極端氣候事件如暴雨、地震、熱浪或停電等，可能對主要營運據點、供應鏈穩定性及出貨時程造成影響，進而增加修復、備援、延遲交貨及營運中斷等短期成本，並對營收認列時點產生不確定性。為降低相關影響，公司已逐步建立初步營運持續與異地備援機制，以強化對突發事件之因應能力。</p> <p>在轉型行動方面，本公司已逐步推動 ISO 14064-1 溫室氣體盤查與碳資料管理作業，並自 113 年度起正式啟動組織型溫室氣體盤查，建立年度盤查與管理機制，並逐步投入節能設備評估、資訊系統優化及環境數據彙整等工作。相關投入短期將反映於管理成本與資本支出，惟中長期可望有助於降低未來碳管理風險、提升法規遵循能力、回應客戶要求，並減少品牌及供應鏈風險所造成之潛</p>

	<p>在財務衝擊。</p> <p>詳情請參閱《2025 年度永續報告書》第二章〈循光綠意前行〉2-1 節「氣候變遷因應行動」。</p>
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>本公司已將氣候相關議題逐步納入整體風險管理架構，由永續發展推動小組統籌協調，並結合各權責單位進行辨識、評估與管理。</p> <p>在風險辨識方面，透過部門訪談、法規蒐整、議題問卷及內部討論，盤點氣候相關實體風險與轉型風險；在風險評估方面，則以風險發生可能性及衝擊程度進行初步評估，並納入年度風險盤點程序；在風險管理方面，現階段已透過 ISO 14064-1 盤查機制啟動環境數據蒐集與內部管理，後續將依公司推動成熟度，逐步強化跨部門追蹤、回報與滾動調整機制，以提升氣候風險管理之制度化程度。</p> <p>相關說明請參閱《2025 年度永續報告書》第一章〈光啟永續治理〉1-4 節「風險管理」。</p>
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>本公司目前尚未正式導入情境分析方法，以評估氣候變遷風險對營運韌性之影響，主因係氣候風險管理制度及相關基礎資料仍處於建置與累積階段，尚未建立完整之氣候參數、情境假設及財務衝擊模擬模型。</p> <p>惟本公司已依循 TCFD 架構，逐步進行實體風險與轉型風險盤點，並透過溫室氣體盤查及內部風險識別流程，建立氣候議題之基礎管理資料，作為後續評估之依據。</p> <p>本項目目前未採用情境分析，相關補充說明請參閱《2025 年度永續報告書》第二章〈循光綠意前行〉2-1 節「氣候變遷因應行動」。</p>
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>本公司目前尚未建立完整之氣候轉型計畫，惟已逐步展開與氣候風險管理相關之基礎作業，並就特定議題進行階段性管理。現階段推動重點包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、啟動組織型溫室氣體盤查，建立排放資料基礎。 二、盤點主要能源使用與高耗能設備，作為節能改善評估依據。 三、初步辨識極端氣候、碳定價、法規調整及客戶碳揭露要求等實體與轉型風險。 <p>目前採用之管理指標主要包括：組織溫室氣體排放量 (tCO₂e)、廠區用電量、用電強度、設備節能改善項目數及碳盤查覆蓋率等。現階段尚未設定明確之量化減量目標，未來將視內部數據累積情形、法規發展趨勢及客戶要求，逐步建構中長期轉型路徑與管理目標。</p>

	詳情請參閱《2025 年度永續報告書》第二章〈循光綠意前行〉2-1 節「氣候變遷因應行動」。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未導入內部碳定價作為規劃工具，主因係公司碳盤查制度與碳管理作業尚處建置初期，現階段以建立盤查邊界、蒐集排放數據及強化內部管理流程為優先，尚未具備訂定內部碳價格之完整基礎。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	<p>本公司目前尚未訂定具體之長期減碳目標或淨零排放時程，惟已建立初步氣候管理方向與階段性工作項目，作為後續目標規劃之基礎。</p> <p>現階段涵蓋活動與範疇，主要以範疇一（Scope 1）與範疇二（Scope 2）為主，包含公司辦公場所、研發據點及主要營運單位之直接排放與能源間接排放；相關活動包括組織型溫室氣體盤查、能源使用管理及設備節能改善評估等。</p> <p>規劃期程方面，114 年已經完成 Scope 1 及 Scope 2 盤查、建置填報制度及內部核對機制為主；115 年規劃進一步提升盤查覆蓋率，進行排放熱點分析及節能改善機會盤點；116 年以後則將視法規與實際推動情形，評估納入 Scope 3 及階段性減量目標設定。</p> <p>截至 114 年底，本公司已完成組織邊界與排放範圍設定、主要營運據點能源使用統計，並建置碳盤查填報表單與內部審核流程。現階段尚未使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）作為達成目標之工具，亦未購買相關碳信用或 RECs。未來將依主管機關政策、客戶需求及公司整體轉型進程審慎評估。</p> <p>詳細內容請參閱《2025 年度永續報告書》第二章〈循光綠意前行〉2-1 節「氣候變遷因應行動」。</p>
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	<p>為回應氣候變遷趨勢及碳管理要求，本公司依 ISO 14064-1:2018 標準，自 114 年度起正式啟動組織型溫室氣體盤查作業，涵蓋竹北總公司營運活動，並完成 114 年度排放清冊建置。1115 年初已委託第三方獨立驗證機構「法標國際認證有限公司」完成溫室氣體查證作業，查證範疇涵蓋第一類至第四類排放，並取得查證報告。</p> <p>本公司溫室氣體盤查及確信情形、減量目標、策略及具體行動計畫，請參閱本年報 1-1「最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」及 1-2「溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫」之說明。</p>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。		
<p>本公司溫室氣體盤查係依據 ISO 14064-1:2018 標準辦理，以營運控制權為基礎設定組織邊界，盤查範圍涵蓋晶彩科技股份有限公司總公司、台中辦公室及台南辦公室。</p> <p>本次盤查結果之主要使用者為公司管理階層及客戶，並以 114 年度為基準年，據以掌握各營運據點之溫室氣體排放現況及趨勢，作為後續減碳目標與管理策略擬訂之依據。</p> <p>114 年度經盤查之各範疇溫室氣體排放量與排放密集度如下：</p>		
年度 \ 範疇 (類別)	113 年	114 年
範疇一/類別一	68.8606	74.4825
範疇二/類別二	634.5331	557.7744
總排放量合計(單位:公噸 CO2e)	703.3937	632.2569
排放密集度	1.05	1.37
範疇三/類別三~六	671.6835	2045.5658
<p>※說明：</p> <p>1. 排放密集度定義為：範疇一（直接排放）加範疇二（能源間接排放）之溫室氣體排放總量（公噸 CO2e）除以當年度合併營收（新臺幣百萬元），以反映每百萬元營收所對應之排放強度。</p> <p>2. 本公司除揭露範疇一及範疇二排放外，亦針對其他具重大影響之間接排放進行盤查。範疇三主要包含與產品使用及營運活動相關之間接溫室氣體排放，例如：能源採購（電力、汽油、柴油、自來水用量）及購買商品與服務所產生之排放等，以逐步擴大盤查邊界並貼近實際碳足跡。</p>		

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
<p>為提升溫室氣體盤查資訊與報告之可信度與透明度，本公司於 114 年度委託第三方公正機構「法標國際認證有限公司」執行外部查證作業，並依 ISO 14064-1:2018 及相關查證準則辦理。</p> <p>確信範圍涵蓋晶彩科技股份有限公司總公司、台中辦公室及台南辦公室，主要地址如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新竹縣竹北市環北路二段 197 號（總公司） • 台中市西屯區西屯路三段宏福五巷 8 號（台中辦公室） • 台南市新市區三民街 139 號 3 樓（台南辦公室） <p>依查證聲明內容，直接排放與能源間接排放（類別一及類別二，即範疇一及範疇二）採「合理保證等級」確信；其他間接排放（類別三至類別六，對應主要範疇三相關項目）則採「有限保證等級」確信，以兼顧實務可行性與資訊可靠性。</p> <p>自 113 年度起，本公司建立年度盤查作業機制，原則上於每年度第一季完成前一年度之內部溫室氣體盤查，以確認各範疇排放量並持續更新基準資料，提供管理階層作為營運決策與減碳策略調整之參考。</p>

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

本公司以 114 年度為溫室氣體管理基準年，結合營運成長與減碳趨勢，訂定中長期減量目標及執行策略，並透過能源管理、廢棄物管理、水資源管理與資源數位化等具體行動推動落實。

一、能源管理：

公司於廠區導入公用設備能源監控系統，針對冰水主機、空壓機及照明空調等高耗能設備進行用電行為分析，透過調整尖峰用電時段與優化設備運轉參數，以降低用電量與溫室氣體排放。

公司原訂於民國 114 年達成年度用電度數較前一年度減少 3%之目標，實際執行結果為減少用電約 12.5%，超越原先設定目標，顯示節能措施具顯著成效，亦將作為後續持續精進之基礎。

二、廢棄物管理：

本公司依污染預防及資源效率原則辦理廢棄物管理，強調「源頭減量、分類回收及安全處理」，以降低營運活動對環境之影響。

公司承諾所有事業廢棄物均以安全且符合環保法規之方式處理，一般事業廢棄物委託具甲級或乙級清除處理資格之環保公司辦理，杜絕事業廢棄物不當流出造成環境污染。

並以廢棄物回收量達 0.5%以上為管理目標，逐步提升回收再利用比例，配合供應商與內部作業改善持續提升循環利用成效。

三、水資源管理：

公司重視水資源之有效使用及品質管理，除每三個月定期更換飲水設備濾芯，確保員工飲用水品質外，並透過內部節水宣導、裝設自閉式水龍頭等措施，降低不必要之耗水行為。

公司訂定年度用水量減少 1%之管理目標，透過持續監測用水數據與改善設備效率，逐步降低單位產出之用水強度。

四、紙本減量與數位化管理

本公司積極推動流程數位化與線上簽核系統，逐步取代傳統紙本表單作業。

預估每年可減少紙張使用約 50,000 張，紙張使用量降低逾 20%，不僅提升作業效率與資訊可追溯性，亦可間接減少紙張生產過程之能源消耗與碳排放，落實資源節約與減碳目標。#

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司經董事會通過訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等誠信經營相關規章，並揭露於公司網站公司治理專區，供董事、經理人及全體員工做為誠信經營之遵循。	尚無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司訂定「誠信經營守則」及「從業道德規範」以確保公司誠信經營，定期舉行董事有關公司治理之教育訓練，並不定期宣導有關企業倫理並於「工作規則」中明定相關獎懲辦法，以防範員工不誠信行為發生，並透過相關內部簽核管理與內部控制制度加以落實。	尚無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		同上所述。並於公司內部進行「誠信經營宣導」，且公司內部、外部網站設置舉報 / 申訴 / 意見反應管道，依性質傳達至專責部門及公司最高管理主管。	尚無重大差異
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司商業交易對象均通過本供應商管理機制，對於已合作之供應商 / 承攬商，亦進行定期稽核與評核，並於合約中訂定相關商業誠信條款。	尚無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司由總經理室負責推動企業誠信經營，偕同相關單位執行，並由內部稽核單位負責稽查事務，確保公司誠信經營理念之落實，且至少一年一次將執行情況呈報董事會。(114年已於11月7日向董事會報告)。	尚無重大差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		對於業務往來上有利害關係者，必須事前告知主管及迴避，以防止利益衝突。董事會各項議案，有利益衝突時，與議案相關之董事皆依迴避原則離席，不參與討論及表決。	尚無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司已依該項法規訂定會計制度、內部控制制度與內部稽核制度。稽核人員每年依不誠信行為方案之遵循情形，並定期於董事會報告。	尚無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「員工職業道德規範」等相關辦法，並公布於公司網站上供董事、員工及利害關係人了解。本公司持續對同仁及主管職人員進行誠信經營與道德行為等相關教育訓練，內容包含誠信經營法規、內線交易及歸入權法規等，確實向同仁宣導公司誠信經營理念並落實於日常工作之中，114年度誠信經營相關教育訓練實體與線上課程參訓人數達36人次，總授課時數為58小時。	尚無重大差異

三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓	本公司已訂定檢舉不合法不道德行為之處理辦法，建立檢舉管道及指定受理單位。	尚無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓	本公司「誠信經營守則」及「員工職業道德規範」，已涵蓋受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。	尚無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓	本公司對於檢舉人負保密之責，避免檢舉人因檢舉而遭受不當處置之措施。	尚無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓	本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等規章，及誠信經營執行和運作情形內容，均揭露於本公司已於本公司網站及公開資訊觀測站，並落實執行。	尚無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 無。			
六、其他有助於瞭解企業誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法等政府相關法令，落實公司誠信經營。			

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司公司治理運作情形，可至公開資訊觀測站或本公司網站查詢。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制聲明書

公開發行公司內部控制制度聲明書

表示設計及執行均有效

(本聲明書於遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明時適用)

晶彩科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115 年 03 月 06 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 114 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115 年 3 月 6 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

晶彩科技股份有限公司

董事長：陳永華



簽章

總經理：陳永華



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議及執行情形

日期	重要決議事項	執行情形
114.05.29.	1. 承認 113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。	本案經出席股東票決後，照案通過。
	2. 承認 113 年度盈餘分派案。	本案經出席股東票決後，照案通過。 除息基準日：114 年 8 月 23 日 發放日期：114 年 9 月 12 日 發放總額：39,526,178 元
	3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	本案經出席股東票決後，照案通過。 114 年 7 月 22 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。
	4. 改選董事(含獨立董事案)。	當選名單如下： 董事： 陳永華 由田新技股份有限公司 代表人：王人傑 由田新技股份有限公司 代表人：許智超 單希基 林宏仁 獨立董事： 王淑珍 李詩政 蘇興華 沈錫文
	5. 解除新任董事及其代表人競業限制案。	本案經出席股東票決後，照案通過。

2. 董事會重要決議

日期	重要決議事項	決議結果
114.05.09	1. 114 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司公司治理主管異動案。 3. 銀行融資額度新增案。 4. 本公司簽證會計師提供預先核准非確信服務之清單。	經出席董事通過
114.05.29.	1. 推選第十屆董事長案。 2. 委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。	經出席董事通過
114.08.08	1. 114 年度第二季合併財務報表案。 2. 113 年度董事酬勞發放案。 3. 113 年度經理人員工酬勞發放案。 4. 經理人晉升案。 5. 114 年度經理人年度調薪計畫案。 6. 董事及重要職員責任保險到期續保案。 7. 銀行融資額度續約案。 8. 董事會授權沈錫文獨立董事管理稽核單位及簽核稽核報告案。 9. 修訂「薪工循環」內部控制制度及「內稽實施細則-薪工循環」部分條文案。 10. 修訂「核決權限表」部分條文案。 11. 修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」部分條文案。 12. 113 年度永續報告書案。	經出席董事通過

日期	重要決議事項	決議結果
114.11.07	1. 114 年度第三季合併財務報表案。 2. 銀行融資額度新增及續約案。 3. 115 年度稽核計畫案。 4. 擬設置「永續發展委員會」暨訂定「永續發展委員會組織規程」案。 5. 委任本公司第一屆永續發展委員會成員案。 6. 指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案。 7. 修訂「核決權限表」部分條文案。	經出席董事通過
115.01.30	1. 114 年度經理人年終獎金發放案。 2. 115 年度預算案。 3. 勤業眾信聯合會計師事務所更換簽證會計師案。 4. 定義本公司基層員工案。 5. 訂定董事酬勞及報酬給付辦法。 6. 115 年重大性主題案。 7. 115 年永續策略藍圖案。	經出席董事通過
115.03.06	1. 114 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 114 年度虧損撥補案。 3. 114 年度營業報告書及 115 年度營業計畫案。 4. 114 年度內部控制制度聲明書案。 5. 銀行融資額度續約案。 6. 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7. 115 年度簽證會計師報酬案。 8. 訂定 115 年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 9. 訂定 115 年股東常會持股 1% 以上股東提案之受理處所及期間案。	經出席董事通過

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費	會計師查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立 葉東輝	2,090	357	114/01/01~114/12/31	(註)

註：其他包含申請技術服務之相對貢獻程度扣繳完稅案 280 仟元、非擔任主管職務之全時員工薪資公費 30 仟元及財報打字印刷費 47 仟元，共 357 仟元。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

前面所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		截至 115 年 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼總經理	陳永華	—	—	—	—
法人董事/大股東	由田新技(股)公司	(1,686,000)	—	(90,000)	—
	代表人：王人傑	—	—	—	—
	代表人：許智超	—	—	—	—
董事	葉勝發	—	—	—	—
董事	單希基	—	—	—	—
董事	林宏仁	—	—	—	—
獨立董事	王淑珍	—	—	—	—
獨立董事	蘇興華	—	—	—	—
獨立董事	曾祥器	—	—	—	—
獨立董事	李詩政	—	—	—	—
獨立董事	沈錫文	—	—	—	—
獨立董事	羅志平	—	—	—	—
執行長	王子越	—	—	—	—
研發副總經理	葉東益	—	—	—	—
公司治理主管	郭龍章(註 1)	—	—	—	—
財務會計及公司 治理主管	曾彩薇(註 1)	—	—	—	—

註 1：郭龍章先生於民國 114 年 5 月 9 日因職務調整卸任公司治理主管乙職，由曾彩薇女士於民國 114 年 5 月 9 日新任公司治理主管乙職，股權變動情形為任職當時之資訊。

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115年3月31日 單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	姓名	關係	
由田新技股份有限公司	8,971,272	11.35%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—
黃旭祺	3,948,000	4.99%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—
陳永華	1,900,813	2.40%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶	1,491,000	1.89%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—
林宏仁	1,394,000	1.76%	2,000	0.00%	—	0.00%	—	—	—
曾烈璽	1,015,000	1.28%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	648,089	0.82%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	646,000	0.82%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶	502,172	0.64%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—
蔡宏仁	400,000	0.51%	—	0.00%	—	0.00%	—	—	—

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114年12月31日 單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Favite Limited	2,000	100%	—	—	2,000	100%
晶隼彩光電科技(上海)有限公司	—	100%	—	—	—	100%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
89.03	10	100	1,000	100	1,000	設立資本	無	89年3月10日經(89)中字第392266號
89.05	10	5,000	50,000	5,000	50,000	現金增資	無	89年6月10日經(89)中字第436229號
91.04	28	5,800	58,000	5,800	58,000	現金增資	無	91年4月29日經授中字第09132041160號
92.01	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資	無	92年1月22日經授商字第09201018260號
93.03	10	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資	無	93年3月17日經授中字第09331825840號
93.11	10	20,000	200,000	20,000	200,000	現金增資	無	93年11月19日經授中字第0933304899號
94.08	10	25,000	250,000	25,000	250,000	現金增資	無	94年8月25日經授中字第09432728210號
95.06	10	50,000	500,000	30,000	300,000	現金增資	無	95年8月07日經授中字第09532612320號
95.11	40	50,000	500,000	38,000	380,000	現金增資	無	95年9月13日金管證一字第0950140080號
96.08	10	50,000	500,000	41,830	418,300	盈餘暨員工紅利轉增資	無	96年7月4日金管證一字第0960034050號
97.02	27	50,000	500,000	46,674	466,740	現金增資	無	97年2月15日經授中字第09731727570號
97.06	0	100,000	1,000,000	46,674	466,740	增加額定資本額	無	97年6月25日經授中字第09732506560號
97.09	10	100,000	1,000,000	57,028	570,288	盈餘暨員工紅利轉增資	無	97年9月05日經授商字第09707887870號
97.11	10	100,000	1,000,000	58,773	587,738	員工認股權	無	97年11月19日經授商字第09701294670號
98.03	10	100,000	1,000,000	58,934	589,348	員工認股權	無	98年03月06日經授商字第09801041060號
98.05	10	100,000	1,000,000	59,008	590,088	員工認股權	無	98年05月21日經授商字第09801101010號
98.08	10	100,000	1,000,000	77,819	778,196	盈餘暨員工紅利轉增資	無	98年08月04日經授商字第09801174880號
98.10	0	150,000	1,500,000	77,819	778,196	增加額定資本額	無	98年10月27日經授商字第09801245410號
100.08	10	150,000	1,500,000	78,597	785,978	盈餘轉增資	無	100年08月12日經授商字第10001186910號
106.04	10	150,000	1,500,000	79,052	790,524	公司債轉換發行普通股	無	106年04月18日經授商字第10604047000號

2. 已發行之股份種類

115年3月31日；單位：仟股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	79,052	70,948	150,000	-

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單：

115年3月31日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
由田新技股份有限公司		8,971,272	11.35%
黃旭祺		3,948,000	4.99%
陳永華		1,900,813	2.40%
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶		1,491,000	1.89%
林宏仁		1,394,000	1.76%
曾烈璽		1,015,000	1.28%
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶		648,089	0.82%
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶		646,000	0.82%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶		502,172	0.64%
蔡宏仁		400,000	0.51%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司股利政策：

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策係配合當年度之資本、財務結構、整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，故本公司之股利分派由董事會視營運需要酌予保留，將以不超過公司可供分派盈餘百分之九十額度分派。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司股利發放採股票股利(含盈餘轉增資、資本公積轉增資)及現金股利二種方式配合辦理，其中現金不低於股利總額之百分之五。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：本公司 114 年度虧損撥補案業經 115 年 3 月 6 日董事會決議擬不予分配股息，尚待本次 115 年 5 月 29 日股東常會決議通過。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本年度無此情形。

(五)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，其中應提撥不低於20%為基層員工之分派酬勞；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

視為會計估計變動，列為股東會決議年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

員工酬勞				董事酬勞	是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異
現金金額 (元)	股票金額 (元)	股票股數 (股)	合計(元)	現金金額 (元)	
0	0	0	0	0	無差異

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者應敘明差異數、原因及處理情形：

單位：新台幣元

分配項目	董事會決議配發金額	認列費用年度估列金額	差異處理	
			差異金額	處理情形
員工酬勞	6,192,273	6,192,273	無	不適用
董事酬勞	1,238,455	1,238,455	無	不適用

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容：

本公司所營事業如下：

- (1) I301010 資訊軟體服務業。
- (2) F213040 精密儀器零售業。
- (3) CB01010 機械設備製造業。
- (4) CE01010 一般儀器製造業。
- (5) CC01080 電子零組件製造業。
- (6) CC01100 電信管制射頻器材製造業。
- (7) CE01030 光學儀器製造業。
- (8) E603050 自動控制設備工程業。
- (9) E604010 機械安裝業。
- (10) F113010 機械批發業。
- (11) F113030 精密儀器批發業。
- (12) F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- (13) F118010 資訊軟體批發業。
- (14) F401010 國際貿易業。
- (15) I501010 產品設計業。
- (16) JE01010 租賃業。
- (17) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	114 年度	
	營業收入	營業比重
自動光學檢測機及維修收入	428,104	93.09%
其他	31,757	6.91%
合計	459,861	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目

產品種類(用途)	產品名稱
TFT Array、TP、LTPS、3D Lens 檢測與量測設備	低解析度自動光學檢測機
	高解析度自動光學檢測機
	素玻璃自動光學檢測機
	突起物自動光學檢測機
	光罩自動光學檢測機
	ADSI 自動線寬量測機
	膜厚量測機
彩色濾光片 (Color Filter) 檢測 與量測設備	LTPS 高解析度自動光學檢測機
	彩色濾光片自動光學檢測機
	高速缺陷拍照機
	突起物自動光學檢測機
	Digital Marco 自動光學檢測機

產品種類(用途)	產品名稱
	CD/OL 量測機
	色度、膜厚、光學密度量測機
觸控面板 (Touch Panel) 檢測與量測設備	Touch Panel 低解析度自動光學檢測機
	Touch Panel 高解析度自動光學檢測機
TFT Cell 檢測與量測設備	PI 自動光學檢測機
	Seal 框膠自動光學檢測機
	Cut Panel/Panel 端子線路檢查機
	Burr Check 切裂自動光學檢測機
	玻璃薄化自動光學檢測機
OLED/AMOLED 檢測與量測設備	OLED 光罩自動光學檢查機
	OLED 乾濕膜框膠檢查/量測機
	OLED 合板檢查/量測機
	Micro OLED TFE 檢查機
	Micro OLED IJP 檢查機
	Micro OLED 光罩檢查機
半導體/先進封裝/高階 IC 載板檢測與量測設備	晶圓級 2.5D 先進封裝 Die Location 量測機
	晶圓級 3D IC Die Location 量測機
	面板級 2.5D 先進封裝 Die Location 量測機
	晶圓自動 AI OM/AVI
	晶圓自動 AI 光學檢測機
	晶圓自動光學檢測機
	FOPLP 多層 RDL 細微線路缺陷檢查機
	TGV 成孔後檢量測機
	Inline Chip on tray 放板不正挑檢機
	各類專業客製化設備
Micro LED 檢測與量測設備	Chip on Wafer / Carrier 晶粒檢測與量測機
	Micro LED Backplane 晶粒 / 線路檢測與量測機
Micro OLED 檢測與量測設備	Micro OLED TFE&CF 缺陷檢測機
	Micro OLED Mask 缺陷檢量測機
	Micro OLED Cover Glass 缺陷檢測機
其他	AI 智能分類解決方案
	多功能光學顯微鏡系統
	良率管理系統
	零配件與維修服務

(二) 產業概況

一、產業之現況與發展

液晶面板顯示產業發展趨勢

2025 年全球液晶面板市場進入「價值轉型期」。受惠於 AI PC 與筆記型電腦換機潮帶動，IT 面板出貨量穩定成長；同時，中國大陸面板廠藉由政策補貼與大尺寸化策略，使 2025 年大尺寸 LCD 出貨面積預計成長約 3%。然而，受全球通膨波動及零組件成本（如記憶體價格）上漲影響，中小尺寸面板需求出現分化，市場競爭焦點由單純「產能規模」轉向「高附加價值產品」。

展望 2026 年，產業將呈現以下三大關鍵趨勢：

1. **顯示規格跨代升級**：隨著 AI 應用落實，PC 與平板面板將全面朝高刷新率、低功耗及超薄化邁進，帶動高階檢量測設備需求。
2. **大尺寸化與特殊應用持續擴張**：電視面板將進一步朝 75 吋以上超大尺寸發展；車載顯示受智慧座艙驅動，多屏與曲面設計成為標準配備。
3. **製程效率優化**：面板廠在折舊期滿後轉向智慧化改造，利用 AI 視覺檢測技術降低生產耗損，確保毛利。

Micro LED 發展趨勢

隨著銻創、友達、群創等台廠供應鏈技術日趨成熟，2025 年為 Micro LED 邁向「實質量產」的關鍵元年。Micro LED 已擺脫單純的實驗室雛形，正式進入高階穿戴裝置與超大尺寸電視市場。根據市場研究，2025 年全球 Micro LED 市場規模預計成長至 18.4 億美元，並引發一波「智慧手錶」與「車載抬頭顯示器 (HUD)」的規格升級潮。由於 Micro LED 具備超高亮度與耐溫特性，在車載透明顯示應用展現出壓倒性優勢，已成為次世代智慧座艙的首選技術。

展望 2026 年，產業將進入「成本優化與製程標準化」的爆發期：

1. **巨量轉移與檢測良率提升**：2026 年市場競爭核心將轉向製程良率控制。隨著巨量轉移技術成本進一步下探，對於高速自動化光學檢測 (AOI) 需求將呈指數型增長。
2. **應用範疇擴及 AI 眼鏡與 XR**：預計 2026 年微縮化 LED (LEDoS) 技術將在 AR/XR 穿戴裝置中取得突破，要求更極致的 PPI (像素密度) 與對位精度。
3. **產業鏈垂直整合**：領導品牌廠將深化與設備商的協作，開發客製化檢量測解決方案。

Micro OLED 發展趨勢

2025 年全球 Micro OLED (矽基 OLED) 產業正式由「技術探索期」轉向「應用擴張期」。受惠於 Apple Vision Pro 及其生態系帶動，Micro OLED 以其超過 3,000 PPI 的高解析度、高對比與輕量化優勢，確立了其在高階 XR (延展實境) 裝置中的主導地位。2025 年市場焦點在於 Tandem OLED (雙疊層) 技術的導入，以顯著提升亮度並解決過往壽命較短的痛點。隨著京東方、視涯科技等面板廠產能擴張，Micro OLED 模組成本預計在 2025 年底開始下探，驅動更多消費級智慧眼鏡與電競頭戴裝置採用。

展望 2026 年，產業將展現以下關鍵發展趨勢：

1. **製程轉向半導體化與精密檢測需求**：Micro OLED 涉及 CMOS 驅動背板與 OLED 蒸鍍技術的深度融合。2026 年隨著解析度邁向 4K 以上，對於晶圓級 (Wafer-level) 的次微米級瑕疵檢測設備需求將迎來爆發。
2. **AI 與光學演算法的整合**：針對 XR 裝置特有的近眼顯示需求，2026 年檢測設備將不僅是「找缺點」，更需整合 AI 演算法進行即時影像校正與視覺感知模擬，以確保終端產品的沉浸式體驗。
3. **多元化應用落實**：除了消費電子外，Micro OLED 將在 2026 年擴大滲透至醫療手術頭盔、軍事模擬與工業遠端協作系統。

半導體封裝測試市場趨勢

2025 年全球半導體產業在 AI 算力需求持續噴發下，先進封裝技術成為延續摩爾定律的核心動能。受限於晶圓級先進封裝產能供不應求，產業鏈正加速朝向 FOPLP (扇外型面板級封裝) 與 2.5D/3D 異質整合轉型。

2025 年，高階 AI 晶片開始大量導入 HBM4 與 Chiplet（小晶片）架構，帶動高階 IC 載板（ABF）與矽中介層（Interposer）的層數增加與線寬線距縮減，這對製程中的瑕疵檢測與對位精度提出了前所未有的嚴苛要求。

展望 2026 年，產業將迎來「大尺寸封裝」與「玻璃基板」的技術拐點：

1. **FOPLP 規模化量產**：2026 年將是 FOPLP 由試產轉向大規模量產的關鍵年，大尺寸面板級載體能提供更高的生產效率並降低 30% 以上的成本。
2. **玻璃基板（Glass Substrate）興起**：為解決散熱與翹曲問題，2026 年高階伺服器晶片將開始導入玻璃基板技術，帶動全新光學量測與自動化光學檢測（AOI）設備的換機潮。
3. **智慧化製程監控**：面對封裝尺寸擴大帶來的良率挑戰，2026 年設備端將深度整合 AI 預測性維護與即時良率分析。

二、競爭情形

晶彩科技作為台灣本土 AOI（自動光學檢測）設備供應商，專注於 TFT-LCD、AMOLED、Micro LED 彩印與顯示產業、半導體先進封裝（Advanced Packaging）、IC 載板產業。以下是針對產業定位與市場競爭環境進行的 SWOT 分析。

優勢（Strengths）

A. 完整的 AOI 檢測產品線，涵蓋多個產業

具備 TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、半導體封測、IC 載板等領域的 AOI 設備開發能力，產品應用範圍廣泛。在 TFT-LCD 與 AMOLED AOI 檢測方面擁有成熟技術，與台灣、中國主要面板廠建立合作關係。

B. 高解析度 AOI 與 AI 智能檢測技術

持續強化高解析度 AOI，提升缺陷檢測能力，如 Micro LED 彩印、FOPLP（Fan-Out Panel Level Packaging）等應用需求。導入 AI 智能 AOI 技術，提升檢測精度，並發展 AI 分類與瑕疵預測功能，提升產品附加價值。

C. 在 Micro LED 產業具有先發優勢

近年積極投入 Micro LED 巨轉前/後製程站點的檢量測設備，與台灣面板廠、中國 LED 顯示產業鏈合作。具備 Micro LED 巨量轉移高速高精度的瑕疵檢測與量測能力。

D. 在半導體先進封裝與高階 IC 載板市場逐步擴展

開發晶圓級/面板級 2.5D 先進封裝 Die location 量測機、FOPLP 超細微 RDL 線路 AOI 檢測機與 TGV 成孔後檢量測機逐步打入先進封裝及高階載板供應鏈。

E. 台灣本土品牌，與面板、半導體供應鏈關係密切

深耕大中華地區 AOI 市場，與兩岸主要面板廠建立長期合作。在半導體先進封裝相關產業逐步擴展，成為合格供應鏈廠商。

劣勢 (Weaknesses)

A. 缺乏全球品牌影響力

與國際 AOI 競爭者（如 KLA、Onto Innovation、Camtek、日立）相比，品牌知名度較低，海外市場拓展較為緩慢。主要市場仍集中於台灣與中國，對北美、歐洲、日本市場的滲透率較低。

B. 研發資源競爭力仍待提升

相較於美、日 AOI 供應商，研發資本較為有限，必須找到自己的利基市場。

C. 缺乏自有核心光學零件供應能力

主要使用國際光學零組件及相機模組，在核心光學技術仍依賴外部供應商，成本控制較難。

D. 產品價格競爭力受限

與中國 AOI 廠商相比，晶彩科技的設備價格較高，在中國市場面臨低價競爭壓力。需要透過提升 AI AOI 智能化與高解析技術來維持競爭優勢。

機會 (Opportunities)

A. Micro LED 產業發展帶來新市場機會

全球 Micro LED 市場預計 2025-2027 年進入量產期，需要高解析度 AOI 檢測與修補技術。預計 2025 年 Micro LED 電視、車載顯示、AR/VR 應用開始放量，AOI 設備需求將快速增長。

B. AI 自動化檢測趨勢

AI 深度學習技術導入 AOI，提高檢測準確度，減少人工誤判，有助於提升競爭力。客戶需求趨勢轉向 AI AOI 自動分類、智能缺陷辨識、即時修補，晶彩可透過軟體開發提升附加價值。

C. 半導體先進封裝市場持續成長

2025-2030 年 HBM (High Bandwidth Memory)、Chiplet 設計快速發展，需要更高精度的 AOI 設備。台積電、三星、Intel 先進封裝產能擴張，將帶動 FOPLP / FOWLP AOI 需求。

D. IC 載板 (ABF / BT) 市場回溫

2024-2025 年 AI 伺服器與 HPC 需求成長，推動 ABF 載板需求，IC 載板 AOI 市場將持續擴大。載板線寬微縮至 2 μ m 以下，檢測設備需求升級，有利於晶彩在高精度 AOI 產品線的布局。

E. 中國面板與半導體國產化政策

中國面板、半導體產業政策扶植本土 AOI 設備商，但仍對台灣 AOI 產品有高度需求。可以通過各種合作方式，提升中國市場市佔率。

威脅 (Threats)

A. 來自國際大廠競爭者的壓力

全球 AOI 領導廠商 KLA、Onto Innovation、Camtek 在半導體檢測市場佔有率高，技術領先且資本雄厚，競爭壓力大。這些國際大廠正積極拓展 Micro LED、FOPLP AOI 市場，將影響晶彩的成長空間。

B. 中國本土 AOI 廠商低價競爭

中國 AOI 廠商在入門設備提供價格更低的選擇，加劇競爭。中國市場對成本敏感，台灣 AOI 廠商需透過技術差異化維持競爭力。

C. 面板與半導體景氣波動

TFT-LCD 市場供需變化快，可能影響面板廠的設備投資規劃。
半導體產業周期性波動，影響 FOPLP、IC 載板設備市場需求。

D. 關鍵零組件依賴外部供應

晶彩科技仍需依賴外國關鍵零組件，如光學鏡頭、相機、AI 晶片等，供應鏈受限。

晶彩科技擁有完整 AOI 產品線，在 TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、半導體先進封裝、IC 載板市場具備競爭力。然而，面臨國際大廠競爭與中國低價威脅，應強化 AI AOI 技術、Micro LED 修補方案、半導體檢測產品線，並積極拓展海外市場，以保持競爭優勢。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	截至 115 年 03 月 31 日
研發費用	196,151	51,274

2. 開發成功之技術與產品

年度	項目
98	雷射碳化修補機：以雷射技術將已經對組完成的面板模組中的亮點在 CF 面碳化。 48WLED：用於高階 AOI 產品檢查光源的高亮度 LED。 ArrayOpen/Short 測試機：應用於 TFTArray 製程中的線路 open 和 short 測試。 RFIDInlay&Tag：以即時影像檢測及光學對位技術運用於 RFID 封裝測試。
99	Touchpanel 高/低解析度自動光學檢測機：運用長週期及多週期比對模式，針對 Touchpanelpattern 進行 defect 檢出。 81WLED：用於高階 AOI 產品檢查光源的高亮度 LED。 3DLCPlens 自動光學檢測機：應用於 3DLCPlens 製程中的 defect 檢出。 OLEDMask 自動光學檢測機：應用於 OLEDMask 的 defect 檢出。

年度	項目
100~102	AMOLED 高解析度自動光學檢測機：運用 1um 高解析度週期比對模式，針對 AMOLEDpanelpattern 進行 defect 檢出及 TFT-LCD, AMOLED 外圍線路檢測功能。 180WLED：用於高階 AOI 產品檢查光源的高亮度 LED。 玻璃薄化自動光學檢測機：應用於玻璃薄化製程中的 defect 檢出。 OGS 自動光學檢測機：應用於 OGS 的 defect 檢出。
103	LTPS 高解析度自動光學檢測機 1. 運用高解析度多週期比對模式，針對 LTPSpanelpattern 進行 defect 檢出。 2. TFT-LCDLTPS 外圍線路檢測功能。
105	半導體晶圓自動光學檢測機 運用高解析度 goldentodie 比對模式，針對 Patternwafer 進行 defect 檢出。
107	G10.5 大世代自動光學檢測機 運用高解析度及高效能演算法，對應大世代面板的產能需求。
105~108	A ⁺ 企業創新研發淬鍊計畫 Panel-level 超微細線路(2 μ m/2 μ m)自動光學檢測，Fan-out 技術開發計畫順利達標結案。
109~111	Horus 智能化光學檢測暨量測機 對比傳統 AOI，為集 AI 檢測、瑕疵複判、分類、自動 2D/3D 量測於一機的產品，適合 Wafer、PCB 載板、封裝等產品的製程品質檢測。
112~114	先進封裝 Die location 量測機
114	高精度及高速 MicroLED 檢量測設備

(四) 長、短期業務發展計劃

為確保公司在自動光學檢測 (AOI) 設備產業中的競爭優勢，我們針對行銷策略、產品策略、生產策略與經營管理策略四個方面，制定短中長期的發展計畫，確保公司持續成長並擴展市場影響力。

1. 行銷策略：

(1) 短期：擴大市場滲透率，深化客戶關係

- A. 強化品牌影響力：參與全球大型展會，增加公司曝光度。
- B. 加強目標市場開發：深入台灣、中國、日本等各地市場。
- C. 數位行銷與精準客戶開發：建立專業技術內容行銷 (如白皮書、技術研討會、線上研討會)。
- D. 強化 AI 數據分析，提高客戶潛在需求的識別精準度。

(2) 中期：全球市場擴展與策略聯盟

- A. 依照市場發展情況，建立海外技術支援據點，提供即時服務與技術支援。
- B. 加強與前後端設備供應商的聯盟，提供完整的封裝測試解決方案。
- C. 與大型半導體封測廠建立深度合作，加速設備導入。

(3) 長期：品牌全球化與多元產業應用

- A. 建立區域化行銷與客戶服務中心，提高全球客戶滿意度。
- B. 品牌升級：打造全球知名的「智能 AOI 檢測解決方案」供應商。

2. 產品策略：

(1) 短期：高解析度與智能檢測技術升級

- A. 開發高解析度 AOI 設備：提升 Micro-bump、RDL、Chiplet 封裝的檢測精度。
 - B. 提升 AI 智能檢測：完善 AI 自適應檢測技術，實現智能缺陷分析，提高檢測效率。提升 AI 自動檢測/自動分類的速度和能力，提高檢測準確率。
 - C. 擴展產品線：新增 3D AOI 設備，應對先進封裝（2.5D/3D 封裝、Fan-Out、TGV）市場需求。
- (2) 中期：模組化與自動化產品
- A. 開發模組化 AOI 設備，降低客製化成本，提高市場適應性。
 - B. 整合多種光學檢測技術，提供全方位異質封裝檢測方案。
- (3) 長期：智能自動檢測與無人工廠
- A. 開發全自動無人工廠 AOI 解決方案，結合 AI 與機器學習，讓設備自動優化檢測參數。
 - B. 推進量子計算、光學元件檢測技術，拓展至新興科技領域。
3. 生產策略：
- (1) 短期：提升產能與供應鏈效率
- A. 優化供應鏈管理：增加與台灣、日本、美國的核心零組件供應商合作，確保關鍵光學與運動控制元件穩定供應。推動供應鏈多元化，降低地緣政治風險對零組件採購的影響。
- (2) 中期：智能化與精益生產
- A. 導入智能製造（Smart Manufacturing），利用 AI 分析與自動化生產提高良率與效率。建構區域生產中心，設立組裝與測試據點，提升當地市場交付能力。
 - B. 持續優化生產流程，導入精實生產（Lean Manufacturing），降低生產成本。
- (3) 長期：綠色生產
- A. 提升生產自動化與智能化水準。強化 ESG 策略，推動綠色製造：採用低碳排製造技術，減少能耗與廢棄物產生。建立碳足跡管理機制，符合國際環保標準。
4. 經營管理策略：
- (1) 短期：提升內部管理效率 強化數位化管理
- A. 提升研發與技術團隊能力：增聘 AI 演算法、光學設計、機械控制專才，提升技術研發能力。
 - B. 優化組織架構，確保市場、研發、生產部門高效運作。
- (2) 中期：國際化與人才培育
- A. 加強國際化管理：設立區域運營中心，提升國際市場的反應速度。
 - B. 推動企業內部創新：設立技術創新實驗室，鼓勵內部技術突破與跨部門合作。
 - C. 強化人才培育計畫：設立內部技術認證與專業培訓，建立優秀的研發與業務團隊。
- (3) 長期：全球營運與 ESG 管理
- A. 全球經營與企業社會責任（ESG）：建立全球化營運管理機制，提高公司營運彈性與風險應變能力。
 - B. 完善 ESG 政策，強化公司在環保、社會責任與公司治理（ESG）方面的表現，提升國際競爭力。
 - C. 擴展新技術領域，確保公司在未來科技趨勢中保持領導地位。
- 透過短中長期策略的規劃，我們將確保公司穩健成長，並在全球 AOI 設備市場中建立競爭優勢。我們將持續投資技術創新、市場拓展、生產升級與管理優化，以實現可持續發展，為股東與客戶創造更大價值。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售地區	年度	114 年度		113 年度	
		營收金額	比重(%)	營收金額	比重(%)
內	銷	179,597	39.05	201,669	30.21
外	銷	280,264	60.95	465,918	69.79
合	計	459,861	100.00	667,587	100.00

2. 市場占有率

(1) TFT-LCD/AMOLED

2024 至 2025 年，中國大陸面板廠在全球 LCD 市場占有率已達 71%，並透過擴產高世代線（G8.5、G8.6、G10.5）及策略整併（如華星收購 LGD 廣州廠）鞏固絕對優勢。OLED 領域，中國在手機應用產能占比近 70%，雖韓國在高端 TV 面板仍持 80% 領先，但中國正積極擴產尋求突破。

面對大陸市場持續的資本支出與龐大檢量測需求，本公司雖受惠於市場動能，卻面臨本土設備商在價格與技術上的激烈競爭。為應對地緣政治與競爭壓力，本公司除積極鞏固固有客戶回購外，正採取兩大突圍策略：

1. 調整產品線性價比組合，提升競爭力。
2. 切入非本公司 AOI 設備的改造升級市場，轉化存量資產為新成長動能。

台灣市場方面，面板雙虎積極轉型新型顯示器與非面板事業，LCD 設備雖僅剩少量新機需求，但既有設備的軟硬體升級改造需求依然穩健。本公司將採「優化存量、佈局新興」策略，維持營運穩定性。

(2) 新型顯示器(Micro LED/Micro OLED)

Micro LED 技術將在消費電子、汽車、娛樂/體育、廣告、航太和國防等多個領域中得到廣泛應用。特別是在智慧型手機、穿戴式裝置和汽車顯示器方面，Micro LED 的需求將顯著增加。晶彩科技挾著本身在檢測量測長期深根累積的專業技術能力，推出 Micro LED 生產製程中一系列的檢量測設備解決方案，成功獲得目前幾個深具指標意義的重要客戶青睞與肯定，在 2025 年仍穩健成長貢獻營收，晶彩科技的全系列檢量測解決方案規劃，透過與關鍵客戶的合作與性能改善迭代，將於 2026 年推出全新一代高速機種。相信後續伴隨著兩岸客戶新實驗線與新產能的擴建，將有助於擴大晶彩科技未來在 Micro LED 項目的營收。

Micro OLED 市場預計將快速增長，特別是在 AR/VR 設備、頭戴顯示器（HMD）、電子取景器（EVF）和投影儀等應用中。到 2030 年，全球 Micro OLED 市場規模預計將達到 19.9 億美元。這些趨勢顯示出 Micro OLED 技術在未來幾年內將有廣泛的應用和巨大的市場潛力。

晶彩科技於 2024 年已開始出貨，目前設備穩定量產中，將持續關注此產業的發展，期望後續能持續為公司帶來營收。

(3) 半導體相關(先進封裝/玻璃載板)

在全球半導體產業邁向後摩爾定律時代，先進封裝技術已成為提升晶片效能、降低功耗的核心動能。根據研調機構 Yole 預測，2023 年至 2029 年全球先進封裝市場的年複合成長率（CAGR）達 11%，市場規模預計將擴展至 695 億美元。其中，2.5D 與 3D 封裝受惠於 AI、HPC（高效能運算）需求，

預計 2030 年產值將達 253.7 億美元，CAGR 高達 17.2%。

隨著 AI 與 5G 晶片尺寸日益龐大，傳統封裝技術面臨成本與散熱瓶頸，使得「扇出型面板級封裝」(FOPLP) 從概念驗證正式轉向可量產化，預期將成為未來先進封裝的新主流。這波技術轉型直接帶動了對高階檢量測設備的龐大剛性需求，成為確保高單價晶片在封裝過程中維持良率與性能的關鍵把關者。

產品佈局：從 2.5D/3D 到 FOPLP 的全面領先

晶彩科技積極投入相關檢量測技術，憑藉深厚的光學檢測實力，已在多個關鍵製程取得實質進展：

- **2.5 D 及 3D 先進封裝檢測：** 在單晶片扇出型封裝 (FOWLP) 領域，本公司現有設備已成功導入國際知名封測大廠產線。針對複雜度更高的多晶片異質整合，本公司開發出「高精度 Die Location 量測設備」，技術優勢在於能同步支援晶片正面 (Face-up) 與背面 (Face-down) 的多種堆疊排列進行精密量測。目前正配合客戶進行深度驗證，旨在爭取高階封裝市場的龐大商機。
- **FOPLP 與 RDL 細微線路檢測：** 憑藉在面板產業累積逾 20 年的玻璃基板檢測經驗，本公司將此技術護城河轉化為 FOPLP 的競爭優勢。針對玻璃基板上的 RDL First (重佈線層優先) 製程，本公司推出可對應多層 RDL 2 微米 (μm) 超細微線路的「FOPLP RDL Fine Line AOI」，並已通過知名載板大廠的驗證測試。
- **TGV 玻璃載板前瞻應用：** 針對 TGV (玻璃穿孔) 載板市場，雖中短期內製程瓶頸仍待克服，但本公司看好其卓越的尺寸穩定性與訊號完整性，已領先佈局適合 TGV 工藝的檢量測解決方案。從開發、試產到量產階段，本公司設備能提供即時反饋與缺陷根源分析，助力客戶優化製程參數，成為玻璃載板廠不可或缺的策略夥伴。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

展望 2026 年，平面顯示器產業已由「產能擴張」轉向「技術溢價」與「應用場景驅動」的新格局。產業供需與成長動能主要體現在以下維度：

1. **AI 硬體換機潮帶動存量市場復甦** 2.0 版的消費電子週期將在 2026 年達到高峰。AI PC 與 AI 智慧型手機的普及，要求更低功耗與更高刷新率的顯示規格，帶動中高階 IT 面板與 AMOLED 滲透率持續攀升。隨著換機週期降臨，市場已擺脫過往需求不振的陰霾，呈現穩健增長態勢。
2. **新型顯示技術進入規模化應用**
 - **Micro LED 與 Mini LED：** 2026 年 Micro LED 已跨越技術門檻，在車載透明顯示、高階穿戴裝置中實現商業化量產。
 - **Micro OLED：** 受惠於空間運算 (Spatial Computing) 與 XR 產業鏈趨於成熟，Micro OLED 成為高階頭戴裝置的標準配備，帶動相關精密檢測設備的強勁需求。
3. **供需格局與地緣政治轉向「韌性供應鏈」** 中國面板廠雖在產能規模佔據絕對主導，但地緣政治風險與區域貿易壁壘促使生產基地轉向多元化布局。2026 年，廠商競爭焦點在於「柔性生產」與「近端供應」，同時透過製程升級與自動化檢測投資來分散人力成本風險，提升營運韌性。
4. **市場規模與長期成長潛力** 全球平面顯示器市場規模在 2025 年已建立穩固基礎，預計 2026 年起，受惠於車載顯示、戶外數位看板及可摺疊設備 (Foldable Devices) 的爆發，市場估值將持續推升。預估至 2034 年前，年複合成長率 (CAGR) 將維持在 6.2% 以上，其中高階顯示技術的成長貢獻占比將大幅提升。

5. **競爭與跨領域創新** 廠商研發重心已由傳統「解析度」競爭，轉向「形態創新」（如滑捲式、摺疊式顯示）與「功能整合」（如螢幕下感測、超薄封裝）。本公司針對這些創新製程所需的精密檢測需求，已提前布局相關 AI 視覺解決方案，以期在 2026 年後的競爭中掌握先機。

總結而言：2026 年的平面顯示器產業將是「技術紅利」收割期。廠商需在靈活產能規劃與前瞻技術投資間取得平衡，方能在 AI 與新興顯示技術疊加的浪潮中，確保領先地位。

中國大陸及韓國面板產業發展狀況

1. 液晶面板 (LCD)：中國大陸產能呈現絕對壟斷

進入 2025 年，中國大陸面板廠在全球 LCD 市場的統治力進一步強化。預計京東方 (BOE) 與 TCL 華星 (CSOT) 在全球 5 代線以上產能市占率合計達 52.6%，整體中國廠商的 LCD 面積市占率更攀升至 72.7%。由於中國大廠持續透過 G8.5 及 G10.5 高世代線進行成本優化與產能整併，全球面板生產及相關檢量測設備的需求重心已高度集中於中國市場。

2. 手機面板：AMOLED 躍升主流，供應鏈結構重組

2025 年手機面板技術發生關鍵轉折，柔性 AMOLED 憑藉其輕薄與顯色優勢，市占份額正式超越非晶矽液晶面板 (a-Si LCD)。

- **京東方 (BOE)：**預計 2025 年出貨量增長至 6.3 億片，穩居全球首位。
- **三星顯示 (SDC)：**雖保有高階技術優勢，但受蘋果 (Apple) 分散供應鏈策略影響，2025 年出貨量預計下滑至 3.65 億片 (年減 3.5%)。
- **陸系二線廠：**惠科 (HKC) 憑藉 G8.6 成本優勢穩住第三；華星 (CSOT) 與小米深度結盟帶動成長；天馬 (Tianma) 則加速從 LTPS LCD 轉向 AMOLED，預計 2025 年受惠 AMOLED 需求年增 10%。
- **趨勢：**2026 年中低階市場 LTPS LCD 將持續萎縮，迫使供應商全面加速 AMOLED 或高階氧化物 (Oxide) 技術轉型。

3. 電視面板：

在電視市場，中韓廠商呈現明顯的技術路線競爭：

- **中國陣營 (Mini LED)：**中國品牌利用完整的上游供應鏈優勢與「以舊換新」政策補貼，全力推動 Mini LED 背光電視普及。2024 年中國市場 Mini LED 滲透率已突破 10%，預計 2025 至 2026 年，隨著背光模組成本下探，Mini LED 將全面下沉至中端放量產品，推動高階 LCD 面板的需求。
- **韓國陣營 (OLED)：**韓系品牌則死守 OLED 技術高地，專注於極致黑與超薄設計。
- **高刷新率與大尺寸化：**2025 年全球高刷新率電視滲透率預計將超過 15%，平均出貨尺寸亦持續擴大，有效拉升了面板的平均售價 (ASP) 與檢量測精度的技術門檻。

總結而言，2026 年的競爭將不再僅限於「產能」，而是轉向「技術滲透率」。中國大陸憑藉政策紅利 (家電補貼) 與龐大內需，成為 Mini LED 與 AMOLED 規模化的核心基地；韓國則力圖在專利壁壘與高利潤市場中尋求突圍。本公司將針對此一區域競爭態勢，靈活調整在中國市場的性價比方案，並鎖定韓國市場的高階研發型檢測設備需求，以實現全球布局的平衡發展。

台灣面板產業發展狀況

產業環境與競爭格局：從價格戰轉向價值戰

近年來，中國面板廠產能占比突破七成，在大尺寸 LCD 與 LTPS 手機面板市場擁有絕對定價權，使台灣廠商面臨劇烈的價格競爭。然而，隨著 2024 至 2025 年產業進入有序生產，加上 AI PC 與高階車載顯示需求回升，台灣面板廠已擺脫連續虧損的陰霾。2025 年上半年，友達已順利轉虧為盈，群創亦透過產品組合優化實現獲利，顯見台灣廠商「去產能、增價值」的轉型策略已初見成效。

關鍵策略：關廠、資產活化與輕資產轉型

面對中國高世代線的規模優勢，台灣廠商不再盲目追求產能擴張，而是採取「輕資產 (Asset-light)」策略。

- **關廠與資產處置**：友達與群創積極關閉效率不佳的舊世代廠房，並將閒置廠房處分子半導體龍頭廠商（如台積電、美光、力成），不僅獲得處分利益改善財務結構，更有效集中資源於高值化製程。
- **雙軸轉型**：友達推動「雙軸轉型」，將顯示技術延伸至智慧零售、醫療及綠能等垂直場域；群創則落實「More than Panel」理念，積極跨足半導體領域。

跨域新引擎：半導體封裝與新型顯示器

台灣廠商利用深厚的玻璃基板處理經驗，成功開拓非面板事業：

- **半導體先進封裝 (FOPLP)**：群創將舊有 3.5 代廠成功轉型為扇外型面板級封裝 (FOPLP) 基地，2025 年已進入量產階段，產線良率突破 90%，成為公司營收的新支柱。
- **Micro LED 與智慧移動**：台灣廠商跳過建置成本高昂的 OLED 產線，全力搶攻 Micro LED。友達透過垂直整合，成功打入全球頂級車廠供應鏈，2025 年在智慧座艙 (Smart Cockpit) 與車用 HMI 領域展現強大競爭力，將面板轉化為高度集成的智慧系統。

展望 2026 年，台灣面板產業將呈現以下關鍵特徵：

1. **獲利優先**：脫離週期性大宗商品競爭，非面板營收占比 (Non-display revenue) 將顯著提升。
2. **AI 與智慧座艙**：結合 AI 運算的智慧顯示系統將成為車載應用主流。
3. **技術護城河**：憑藉在 Micro LED、FOPLP 與高階顯示系統的先發優勢，台灣廠商將在 AI PC 與電動車浪潮中扮演不可或缺的供應鏈角色。

(2) Micro LED 技術發展趨勢與市場的未來成長性

技術核心與產業優勢：定義顯示技術的終極型態

Micro LED (微發光二極體) 被全球公認為次世代顯示技術的「明日之星」，其核心價值在於將 LED 結構進行微縮化與矩陣化 (晶粒通常小於 50μm)。該技術結合了無機 LED 的高亮度、高效率、高可靠度及奈米級反應速度，同時具備自發光、體積微型化、輕薄化與超低功耗等特性。

與目前主流的 OLED 相比，Micro LED 完全解決了螢幕烙印 (Burn-in) 與亮度衰減的痛點，其亮度上限與耐溫範圍顯著提升，使其在智慧型手機、穿戴式裝置、智慧座艙、AR/VR 沉浸式設備及大型 TV 等領域展現極強的競爭力。雖然過去受限於「巨量轉移 (Mass Transfer)」良率與「缺陷檢修」成本，但步入 2025 年，隨著製程標準化的確立與關鍵設備的升級，產業已正式從技術驗證期跨入規模量產元年。

全球區域競爭格局：區域化策略與技術分工

全球主要顯示供應鏈對 Micro LED 的布局已展現出明顯的區域分工與競爭策略：

- 1. 台灣廠商：轉型先驅與生態系整合中心** 由於在 OLED 技術布局上落後於韓、中廠商，台廠近年來積極將 Mini LED 的成功經驗轉化為 Micro LED 的發展動能。以友達 (AUO)、群創 (Innolux) 及銻創 (PlayNitride) 為核心的台廠陣營，已建立全球最完整的 Micro LED 生態系。2025 年，台廠在巨量轉移至 PCB 與玻璃基板的製程上取得重大突破，良率顯著提升。工研院透過整合產研機構，串起從發光材料、轉移製程到缺陷偵測與修補的完整技術鏈。展望 2026 年，台廠將結合半導體封裝與面板技術優勢，鎖定高利潤的車載市場與高階 IT 顯示，穩坐全球技術研發與代工領頭羊。
- 2. 中國大陸廠商：規模優勢與全產業鏈滲透** 中國廠商憑藉全球最大的面板產能與政府補貼，展現出強大的追趕實力。京東方 (BOE) 與 TCL 華星 (CSOT) 在專利申請量上已躍居全球前列。中國市場的優勢在於全鏈條整合，涵蓋上游晶片、中游封測到下游終端應用。儘管在極小尺寸的轉移精度上與台廠仍有差距，但其在在大尺寸看板與中端消費性產品的規模化降本速度極快。2026 年，預計中國廠商將透過高性價比方案，加速 Micro LED 在大尺寸商顯與主流顯示市場的滲透。
- 3. 韓國廠商：高階品牌防禦與策略性結盟** 韓國雙雄三星 (Samsung) 與 LGD 在 2025 年採取「分級競爭」策略。雖然目前獲利重心仍在 OLED，但為避免技術斷層，三星積極推動「The Wall」系列模組化電視，鎖定家庭劇院與高奢市場。韓廠目前傾向與台灣技術供應鏈進行策略合作，利用其強大的終端品牌影響力，試圖在 2026 年前定義 Micro LED 的頂級規格。
- 4. 歐美日廠商：專利布局與特定應用先鋒** 日本 SONY 依然在大型高畫質顯示器領域保持領先地位。歐美廠商如 Apple 與各類新創公司，則專注於學術創新與微型顯示 (LEDoS) 的專利授權與收購。歐美陣營的策略主要在於收購關鍵技術節點，並將重點放在 XR 產業的小型化光引擎開發。其產品多聚焦在醫療、軍事模擬及穿戴裝置，並多採與亞洲廠商合作開發的模式。

展望 2026 年，Micro LED 市場將迎來兩大剛性需求的噴發點：

- 1. 空間運算時代的 XR 設備需求** 根據研調機構數據，2026 年全球 AR 市場產值預期將突破 600 億美元。Micro LED 因具備高亮度、高解析度與極微小體積，是目前最符合 AR、MR 需求的顯示技術。隨著 Meta、Apple 等大廠在 2026 年推出更輕便的智慧眼鏡，Micro LED 晶粒微縮與高 PPI 的檢測需求將呈現指數型增長。
- 2. 智慧駕駛與透明顯示的應用落實** 2026 年全球智慧座艙需求將攀升。Micro LED 具備的高透光性與耐極端環境特性，使其成為透明車窗顯示、抬頭顯示器 (HUD) 的標配。台廠與國際車廠的四年期合作計畫將在 2026 年進入驗證收割期，這將為設備商帶來更高毛利與技術門檻的訂單，將面板從單純顯示組件轉化為高度集成的智慧系統。

總結而言，2025-2026 年是 Micro LED 從「技術領先」轉向「市場普及」的關鍵轉折點。儘管目前成本相對於 OLED 仍偏高，但隨著製程設備 (如 AOI、缺陷修補、巨量轉移設備) 的技術進步，生產良率提升將驅動成本每年下探 20% 至 30%。

在全球半導體與顯示產業交織的浪潮下，Micro LED 不再只是顯示技術，更是一項整合光電、精密機械與 AI 演算法的跨領域成就。本公司將持續投入相關高精度檢量測設備的開發，鎖定 Micro LED 關鍵製程中的良率痛點，助力客戶在 2026 年後的量產浪潮中取得領先，為股東與產業鏈創造長期的價值成長。

(3) Micro OLED 技術發展趨勢與市場的未來成長性

技術核心與戰略地位：

Micro OLED（亦稱矽基 OLED / OLEDoS）是將傳統 OLED 發光技術與半導體 CMOS 驅動背板深度融合的新型顯示技術。其核心優勢在於能在微小尺寸內達成極高解析度（超過 3,000 PPI）、超高對比度與微秒級反應速度，且具備低功耗與輕薄特性，已成為高階 XR（VR/AR/MR）近眼顯示器的首選方案。隨著 Apple Vision Pro 確立了「空間運算」的產業方向，Micro OLED 作為提供極致沉浸感與消除紗窗效應的關鍵硬體，正迎來技術爆發期。

2025-2026 發展現況：由實驗室產線邁向量產規模化

2025 年 Micro OLED 產業正式克服了良率不穩與供應鏈破碎的初期挑戰。在全球顯示大廠的推動下，生產製程已由 8 吋晶圓轉向 12 吋晶圓量產，顯著提升了生產效率並降低單位成本。

- **技術迭代：**2025 年起，「Tandem OLED（雙疊層）」結構的導入成為技術主流，有效解決了 Micro OLED 過往亮度不足與壽命較短的痛點，使其在戶外 AR 應用場景中更具競爭力。
- **市場動能：**隨著 2026 年消費級 XR 裝置預計迎來新一波發布潮，Micro OLED 的市場規模正呈現指數級成長。根據研調機構預測，2026 至 2027 年將是 Micro OLED 產能放量的關鍵節點，出貨量將與 Micro LED 並駕齊驅，共同瓜分高階顯示市場。

中國廠商的主導地位與產業鏈佈局

目前中國廠商在 Micro OLED 領域的投資力道與產能佈局最為積極，已成為全球產量增長的核心驅動者。其中視涯科技為中國最大的 Micro OLED 領軍企業，視涯科技持續深耕高解析度微顯示技術，並在 XR 市場占有重要地位。另外，熙泰科技在安徽與綿陽的佈局已初見成效。其 12 吋 Micro OLED 產線已於 2024 年實現產品點亮，並在 2025 年進入規模化量產，大幅提升了區域性顯示產業的技術能見度。整體而言，中國大陸已形成從上游驅動 IC、發光材料到下游終端模組的完整產業鏈，吸引了大量投資進入新型顯示領域。

檢量測設備的剛性需求與市場契機

Micro OLED 的製程融合了半導體精密工藝與面板顯示技術，這對「晶圓級（Wafer-level）檢測」提出了前所未有的嚴苛要求，隨著熙泰、視涯等大廠擴產 12 吋產線，相關自動化檢量測設備的採購需求同步爆發。本公司鎖定這一塊剛性需求，憑藉高精度光學演算法，為 Micro OLED 廠商提供從製程開發到量產良率提升的全方位解決方案。

展望 2026 年，Micro OLED 將在高階穿戴、醫療手術頭盔與軍事模擬等領域展現巨大潛力。儘管目前仍處於普及化的前夕，但隨著製程工藝的成熟與大廠導入，其市場成長性不容小覷。本公司將持續深化在 Micro OLED 檢測領域的佈局，掌握次世代顯示器技術的核心話語權。

(4) 先進封裝市場與發展趨勢

隨著 AI（人工智慧）與 HPC（高效能運算）需求邁入爆發期，全球半導體產業已從單純的「製程微縮」演進至以「異質整合」為核心的先進封裝時代。根據研調機構 IDC 與 Yole 最新數據，全球先進封裝市場規模預計將從 2023 年的 443 億美元成長至 2026 年的 576 億美元。關鍵的轉折點發生在 2025 年下半年，先進封裝的產值占比首度正式超越傳統封裝，象徵著封裝技術已從後段工序轉變為決定 AI 晶片效能的戰略核心。

其中，以 CoWoS 與 SoIC 為代表的 2.5D/3D 堆疊技術表現最為強勁，預計 2026 年其市場規模將突破 75 億美元，年均複合成長率（CAGR）高達 18% 以上。這波成長主要受惠於輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）及超微（AMD）等大廠對高寬頻記憶體（HBM）與運算核心進行高密度封裝的剛性需求。

國際大廠產能布局：全球擴廠浪潮與技術卡位

台積電作為全球先進封裝的技術定義者，正以驚人的速度擴張。2025 年下半年，其收購自群創的南科廠（AP8）將正式投產，協助緩解長期供不應求的 CoWoS 產能。大摩（Morgan Stanley）最新調查指出，台積電 2026 年 CoWoS 月產能規劃將進一步提升至 12.5 萬片。此外，次世代 3D 封裝技術 SoIC（系統整合晶片）將在 2026 年邁向量產爆發期，預計產能將年增超過 120%，鎖定 2 奈米世代的 AI 伺服器與邊緣 AI 晶片。此外，為確保 AI 供應鏈穩定，英特爾（Intel）、三星（Samsung）及美光（Micron）紛紛展開全球擴廠。英特爾在美國新墨西哥州與馬來西亞檳城的大型產線已陸續到位；三星則憑藉記憶體與代工的一體化優勢（Turnkey），在韓國積極建置 2.5D 封裝能量。記憶體龍頭 SK 海力士與美光則分別選址美國印第安納州與台灣，建置專屬 HBM 的先進封裝基地。

在台灣的封測廠方面，台灣 OSAT 廠商在全球先進封裝版圖中扮演「外溢訂單」與「異質整合」的關鍵角色，以日月光來說，預計 2026 年先進封裝營收目標將較 2025 年翻倍，衝刺至 32 億美元以上。日月光憑藉 VIPack™ 平台與 FoCoS 技術，成功承接台積電委外的後段測試與封裝（WoS）訂單，並深耕北美與東南亞產能，鞏固其全球封測霸主地位。而力成則採取「空間先行」策略，布局 FOPLP（扇出型面板級封裝）與高階 HBM 測試，為 2027 年後的玻璃載板應用預作準備。

展望 2026 年，先進封裝產業將呈現兩大變革：

1. FOPLP 規模化：由於傳統 12 吋晶圓封裝面積有限，FOPLP 利

用大尺寸玻璃基板提升封裝密度與降低成本，預計在 2026 年將正式跨入高階手機與邊緣 AI 處理器市場。

2. 檢量測設備需求激增：TrendForce 報告指出，先進封裝製程愈趨複雜，對「高精度光學檢測」的需求將在 2025-2026 年帶動設備商營收年增逾 20%。

2026 年的半導體產業已全面進入「AI 封裝決定論」時代。台灣廠商憑藉台積電的領先地位與 OSAT 陣營的靈活調度，將在 2.5D/3D、FOPLP 及相關檢量測設備領域，持續扮演全球 AI 生態系中不可或缺的核心支柱。

4. 競爭利基

本公司自成立以來隨著面板技術的演進不斷致力於研發技能的開發，初期以 24 位元全彩影像技術為核心，進而開發諸如彩色圖像識別演算法、光學取像技術、照明系統、精密機械設計、光機電控制整合、數位影像處理電路及缺陷智能

分類等相關技術，並為客戶提供全彩、高解析度、精確、快速且完全量身訂做的檢測機，目前所開發的產品，皆已經過國內外面板大廠的認證與肯定，可增加既有設備升級的營收和新技术新購設備以減緩產業受到疫情之影響。

茲就本公司之競爭利基分析如下：

(1) 人才

本公司擁有整合來自物理、數學、機械、自動控制、光電、資訊等各領域的人才與堅強的研發團隊，除可持續創新、改良各相關領域技能，亦可滿足客戶開發的需求，所以，目前技術的開發業已領先其他國內競爭廠商。

另外管理人才方面，本公司均積極提供員工外部專業的產業教育訓練，增進各職位所需新領域之專業知識，以面對不斷進步變遷的大環境，達到理論與實際結合應用的目標。而這些專業的人才，正是公司不斷開創新產品的原動力，並和公司之發展一起與時俱進。

(2) 技術

在檢測設備開發的領域上，本公司除影像辨識的核心技術領先同業外，在光學系統的設計亦以突破薄膜電晶體高解析檢測設備所需的多通道光學設計，是國內唯一通過客戶認證高解析檢測設備的公司；另在量測設備的開發領域上，經由多年的努力，本公司已完全具備量測設備開發的核心技術，包括可對應面板、新型顯示器及先進封裝的高精度 CD/OL 量測、色度/膜厚/光強密度、白光干涉測高等技術，此為國內業界少數具有完整核心技術的公司。

(3) 產品

本公司經由過去技術經驗的累積，檢測、量測相關產品線業已完整，主要涵蓋薄膜電晶體廠、彩色濾光片廠及 AMOLED 面板組裝廠，此諸多產品皆已經過國內外面板大廠的認證與肯定，銷售實績也日益成長，並成為台灣高解析檢測設備市場佔有率第一，TP 檢測設備市場佔有率第一的專業廠商。

2017 年跨足半導體產業，發表自動 Glass Wafer 檢查機獲得國內知名半導體廠成功導入。

2019 年及 2020 年在不斷的研發新技术下，受到客戶的肯定，在高階的面板 Mini LED，車載面板技術上突破並取得相關訂單。另外，獲得經濟部主導性科專計畫，開發應用於 FOPLP 多層 RDL 的 2um RDL 超細微線路 AOI。

2021 年則發表發表 AI 即時自動光學檢測系統，並與知名 PCB 及 Micro LED 先驅大廠合作導入。

2022 年發表了 FOWLP Die Location 量測機，獲知名封測大廠採用。

2023 年則推出 Micro LED/OLED 一系列檢量測 AOI，獲知名新型顯示面板大廠採用。

2024 年則開發出適用於先進封裝及玻璃基板的 Die location 量測機及 TGV AOI。

(4) 價格

本公司針對設備開發所需要的主要核心技術均自行開發，故較其他廠商有競爭力；且主要的關鍵零組件，如特殊的檢測光源，本公司除自行開發亦尋求專業供應商以達到技術提升和降低成本，而由於目前本公司產品之量產需求已達規模經濟，更可有效降低購買及生產成本，故本公司可以提供比國外設備商更有價格競爭力的檢測、量測設備，嘉惠國內外面板製造廠商。

(5) 服務

本公司於台灣、大陸設有服務據點，就近提供便捷及完善之維修服務與技術支援，使客戶產生之問題能在即時獲得解決，隨時配合進行軟、硬體方面適度修改，快速回應客戶需求及提供服務，增強產品之功能性及競爭力，取得客戶之信賴。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 中國大陸 TFT-LCD、AMOLED、MiniLED 與 MicroLED 產業蓬勃發展

2015 至 2019 年間，中國大陸 TFT-LCD、AMOLED 大量建廠與擴產，雖產能過剩的疑慮與疫情之不確定性仍高，但中國大陸仍是傳統 TFT-LCD 產業與未來 AMOLED、MiniLED、MicroLED 產業投資的主要市場，平面顯示器產業已在中國大陸建立起龐大的產業鏈，為後續的新技術 (AMOLED、MiniLED、MicroLED) 與新應用 (8K 電視、車載面板、穿戴設備等) 帶來龐大的發展契機。本公司憑藉多年於 TFT-LCD、LTPS 之布局與實績基礎上，積極朝此趨勢發展，並掌握此成長契機，即時擷取市場機會。

B. 產品已獲得客戶的認證

本公司於公司成立初始即投入 FPD 面板設備研發，產品範圍涵蓋檢測、量測設備等，皆已獲得，國內及中國大陸面板大廠之認證，這些主要客戶亦是目前發展 LTPS TFT-LCD、AMOLED、MiniLED、MicroLED 的主要廠商，因此，對於公司搶攻國內外面板大廠之未來新技術市場是非常有利的因素。

C. 擁有優良技術的研發團隊

本公司除擁有優良技術的研發團隊，已經整合來自物理、數學、機械、自動控制、光電、資訊各領域的人才與知識，核心技術的開發涵蓋 AOI 演算法檢測/AI 即時檢測、智能缺陷辨識、異形檢測、長週期與無週期畫素設計檢測、二維量測及三維測高等技術，在檢測量測領域領先其他同業，並可針對任一客戶客製化專業設備。

(2) 不利因素與因應對策

A. 中國大陸當地 AOI 競爭對手興起並採低價策略，不利產品推廣

2015 年以來，TFT-LCD 產業在中國大陸的興盛也帶動了其當地 AOI 廠商的興起，且當地政府之補貼政策，更利於其在售價上之競爭上，因此，當地之 AOI 廠商亦在非高端製程與非高解析度缺陷檢測的 AOI 市場上佔有一席之地。

因應對策：於既有客戶基礎上，與客戶持續開發高端製程與高解析度缺陷檢查機，並及早進入 Micro LED、Micro OLED 領域，了解製程重點與客戶需求方向，進行更先進的光學系統與檢測演算法開發，並以積極的服務精神與良好的互動關係，讓客戶對公司的技術及服務具有信心，以縮短新產品推廣期間。

B. 客戶的收款期長，不利公司之資金有效運用

TFT-LCD 設備業一般按交機及驗收完成收款，而驗收時間有時長達一年以上，由於本公司目前資本規模尚小，故於營收快速成長的過程中，對於大量營運資金的需求及調度，應審慎規劃。

因應對策：不斷藉提升產品品質、服務品質及裝機效率等方式，以縮短收款時間，並持續與往來金融機構建立密切關係，關注市場之金融脈動，提升財務運用之績效。

本公司為國內極少數擁有全方位核心技術，能於 TFT-LCD、AMOLED、TP、LTPS 面板產業的檢測、量測設備全面自主開發的設備製造廠商，目前已通過友達光電、群創電子、及大陸相關 TFT-LCD 面板廠的驗證及實際交機，且自 2006 年起已獲得大量訂單，2008 年並勇奪 G8.5 Array 段台灣市場佔有率第一名，而自 2009 年起，更成功進入中國大陸面板市場，直至 2019 年，已成為中國大陸各大面板廠 Array 製程的自動光學檢測及拍照設備主要供應商之一，另外在 TP sensor、AMOLED 及 LTPS AOI 亦獲得客戶的肯定。另外，近幾年積極轉型跨足半導體先進封裝、玻璃載板、Micro LED/Micro OLED 等多個專業領域，提供客戶高精度、高品質的自動光學檢測與量測設備與良率監控完整解決方案。

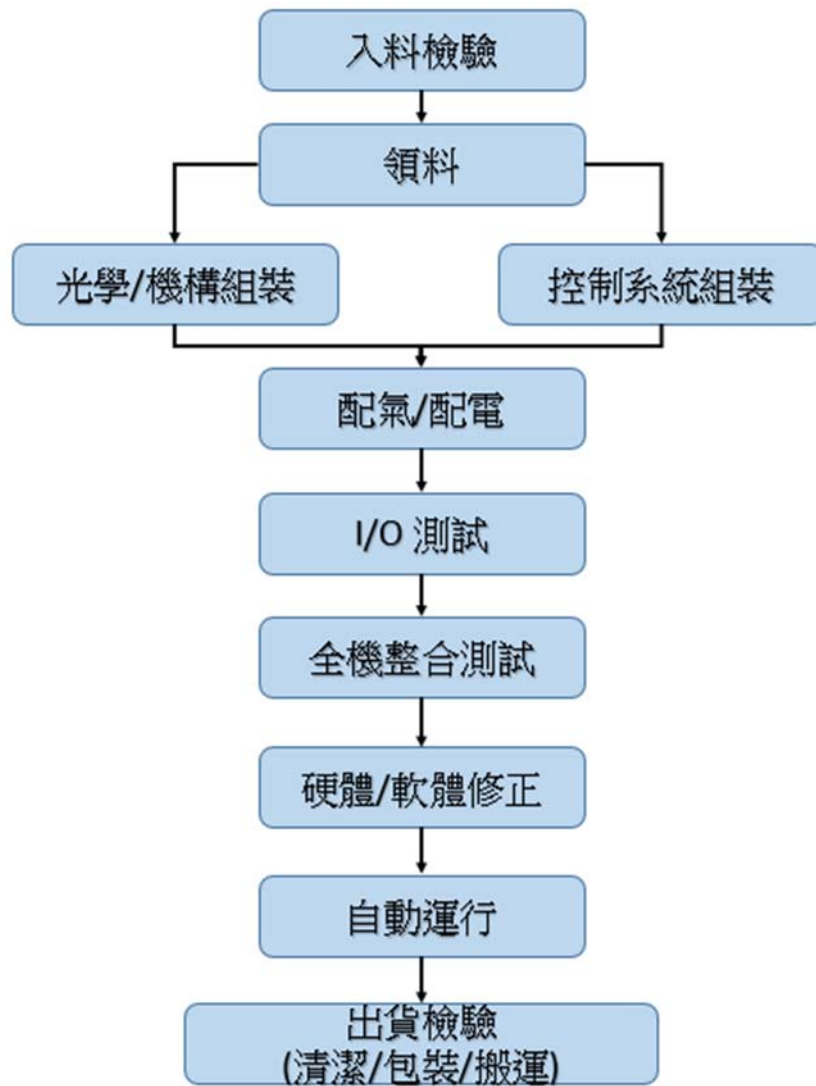
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

產品種類	產品名稱	主要用途
TFT Array、AMOLED 檢測、Mini LED 檢測、量測、修補設備	薄膜電晶體低解析度自動光學檢測機	薄膜電晶體各道製程的全面瑕疵檢測，解析度較低但可以全面檢測
	薄膜電晶體高解析度自動光學檢測機	薄膜電晶體各道製程的瑕疵抽檢，解析度較高但解測時間長，故通常係採用抽檢
	素玻璃自動光學檢測機	素玻璃的瑕疵檢測
	Mini LED 自動光學檢測機	Mini LED 各道製程的瑕疵抽檢，可以克服產品多樣性及長周期比對檢測核心
	光罩自動光學檢測機	石英光罩及 OLED 金屬光罩的瑕疵檢測
	ADSI 自動線寬量測機	薄膜電晶體各道製程的線寬線距量測
	膜厚量測機	薄膜電晶體各道製程的膜厚量測
ColorFilter 檢測、量測、修補設備	彩色濾光片自動光學檢測機	彩色濾光片的瑕疵檢測
	高速缺陷複檢機	將自動光學檢測機所檢測出的瑕疵以高解析度相機拍攝供人員或電腦對缺陷重新複檢
	突起物自動光學檢測機	彩色濾光片玻璃突起物的檢測，以防止玻璃上的突起物將昂貴的光罩刮傷
	DigitalMarco 自動光學檢測機	面板色不均(Mura)的瑕疵檢測

產品種類	產品名稱	主要用途
	CD/OL 量測機	彩色濾光片各道製程的線寬線距量測
	色度、膜厚、光學密度量測機	彩色濾光片 RGB 製程的色度量測，PS/MVA/OC/ITO 製程的膜厚度量測，BM 製程的光學密度量測
TouchPanel 檢測、量測設備	TouchPanel 低解析度自動光學檢測機	TouchPanel 低解析度 defect 自動光學檢測
	TouchPanel 高解析度自動光學檢測機	TouchPanel 高解析度 defect 自動光學檢測
	CD/OL 量測機	TouchPanelCD/OL 量測
TFTCell 檢測、量測、修補設備	PI 自動光學檢測機	PI 的瑕疵檢測
	Seal 框膠自動光學檢測機	框膠的瑕疵檢測
	BurrCheck 切裂自動光學檢測機	切裂的瑕疵檢測
	ParticleCounter 粒子檢查機	粒子檢查
PCB 及封測檢測設備	Fan-Out Panel level RDL 超細微線路檢查機	檢查 Fan-Out Panel level 的超細微 RDL 線路缺陷
	Wafer level 切割後 Chip 外觀檢查機	檢查晶粒切割後的邊緣缺崩裂及表面缺陷
	各類專業客製化設備	針對不同 PCB 及封測廠提供專業客製化的檢測解決方案
Mini/Micro LED 檢測、量測設備	Horus 智能化光學檢測暨量測機	Mini/Micro LED 製程的品檢，包含 2D 量測(尺寸/偏移/旋轉)、3D 量測(傾斜)、各種物件的外觀尺寸量測與異常缺陷檢測。
	AI 智能缺陷辨識系統	搭配 Horus 進行缺陷訓練與辨識
其他	多功能光學顯微鏡系統 各類專業客製化設備	提供客戶所有放大觀察需求的全方位解決方案。
	AI 智能分類解決方案	可搭載在晶彩不同的檢測設備上進行缺陷即時分類及篩選濾除。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

原料名稱	供應情形
光學與光電零組件	良好
電機電子零組件	良好
傳動零組件	良好

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及進(銷)貨金額與比例

單位：新台幣仟元

1. 主要進貨供應商情形單位

項目	113年			114年			115年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	甲廠商	26,539	13.82	乙廠商	41,570	11.39	丙廠商	26,316	30.63	無
2	乙廠商	10,906	5.68	丙廠商	33,011	9.04	丁廠商	11,346	13.21	無
3	丙廠商	4,400	2.29	丁廠商	24,768	6.79	乙廠商	5,765	6.71	無
4	丁廠商	1,992	1.04							
4	其他	148,154	77.17	其他	265,638	72.78	其他	42,486	49.45	無
	進貨淨額	191,991	100.00	進貨淨額	364,987	100.00	進貨淨額	85,913	100.00	

變動說明：甲廠商為本公司自動化設備之代工廠商，本年度本公司產能足夠支撐訂單，故委請廠商代工之金額下降。

2. 主要銷貨客戶情形單位

單位：新台幣仟元

項目	113年			114年			115年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	客戶一	345,242	51.71	客戶五	151,521	32.95	客戶六	232,880	71.59	無
2	客戶二	99,555	14.91	客戶六	77,680	16.89	客戶三	49,426	15.19	無
3	客戶三	92,674	13.88	客戶四	51,323	11.16	客戶五	39,879	12.26	無
4	客戶四	6,805	1.02	客戶三	49,174	10.69	客戶二	553	0.17	無
5	客戶五	843	0.13	客戶一	31,663	6.89	客戶一	290	0.09	無
6				客戶二	11,757	2.56				
7	其他	122,468	18.34	其他	86,743	18.86	其他	2,271	0.70	無
	銷貨淨額	667,587	100.00	銷貨淨額	459,861	100.00	銷貨淨額	325,299	100.00	

變動說明：本公司銷售自動光學檢測機係以客戶之需求為主，視客戶當年度有無擴廠或汰換設備計劃而影響本公司銷貨金額。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		113 年度	114 年度	115 年度 (截至 115/03/31)
員工	直接人員	75	73	73
	間接人員	137	137	136
人數	合計	212	210	209
平均年歲		41.21	40.7	40.9
平均服務年資		7.95	8.83	9.03
學歷分布	博士	1	1	1
	碩士	31	33	33
	大專	62	61	61
	高中	6	5	5
	高中以下	-	-	-

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司無因污染環境或違反環保法規而遭受主管機關處分之情形，亦無相關罰鍰、賠償或環境復育支出等損失。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施

本公司秉持與員工共享營運成果之理念，依法設立「職工福利委員會」，並依「各項福利津貼補助辦法」規劃多元福利措施，以安定員工生活並保障其權益。

主要福利措施包括：

- (1) 年終績效獎金
- (2) 員工分紅獎金
- (3) 年度調薪
- (4) 依法給付加班費或補休
- (5) 端午/中秋禮券及生日禮券
- (6) 婚喪及生育補助金
- (7) 研發專利獎金
- (8) 公司全額負擔的團體保險(壽險、意外險、醫療險及癌症險)
- (9) 團體海外商務旅行平安保險
- (10) 勞保、健保、勞工退休金 6%提撥

- (11) 優於法令 - 每季提供 1 日活力假(新進同仁到職即預先給假)
- (12) 優於法令 - 每年辦理多元項目之員工健檢
- (13) 特別休假
- (14) 專業護理師諮詢服務
- (15) 福委會社團活動與社團補助金
- (16) 年度員工旅遊或旅遊補助金
- (17) 部門聚餐補助
- (18) 年度尾牙或春酒活動
- (19) 不定期舉辦各類競賽或員工活動
- (20) 便利且免費之汽/機車停車場
- (21) 孕婦及傷病同仁專屬停車格
- (22) 員工哺(集)乳室設置
- (23) 提供員工制服
- (24) 員工代訂餐服務
- (25) 提供出差宿舍

2. 進修、訓練

- (1) 本公司視員工為重要資產，逐年編列教育訓練預算，依「教育訓練管理程序」規劃內外部課程，協助員工持續精進專業技能與管理能力，以因應產業與技術快速變化，提升工作績效與產品服務品質，並強化個人及組織競爭力。
- (2) 114 年度進修與訓練實施情形如下：

單位：新台幣元

課程類別	班次數	總人次	總時數	費用	總費用
一般共通類	19	358	941.5	0	1,227,160
管理類	11	187	1,427.5	1,035,000	
專業技術類	70	392	1,190	108,000	
工安及法令要求類	75	311	1,085.5	84,160	

3. 退休制度及其實施情形

為保障員工退休後之生活，本公司依相關法令規定同時建置勞動基準法及勞工退休金條例兩軌制度辦理退休金提撥：

- (1) 依《勞動基準法》設置退休準備金監督委員會，按月提撥退休準備金至中央信託局退休專戶，並訂定「勞工退休辦法」作為舊制退休金核發之依據。
- (2) 依《勞工退休金條例》規定，由公司按月提繳員工工資 6% 至勞工保險局個人退休金專戶，退休金歸屬員工個人所有，員工並得自願提繳，以強化退休儲蓄。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- (1) 本公司重視勞資和諧，依法辦理並多項制度優於法令規定，每季定期召開勞資會議及職業安全衛生委員會，由勞資雙方就重要議題充分溝通協調，近年並無重大勞資爭議或糾紛情事。
- (2) 成立職工福利委員會並定期每季召開會議，由各單位代表共同討論福利方案，持續優化員工福利措施。
- (3) 鼓勵員工積極參與內外部訓練及技能培訓，提升專業職能與職涯發展機會。
- (4) 提供勞保、健保及團體保險，海外出差同仁另加保團體商務旅行綜合保險，以提供全面風險保障。
- (5) 每年辦理員工健康檢查，並依檢查結果安排後續健康追蹤與管理。

(6) 鑑於現代生活型態及工作壓力，114 年度員工健檢特別聚焦心血管疾病風險，協助員工透過檢查數據早期發現異常，對高風險族群由職護及職醫提供衛教及諮詢服務。同年並舉辦全體員工運動會，鼓勵規律運動與健康飲食，營造健康職場文化。

(二) 說明最近年度截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司最近年度截至年報刊印日止，無因勞資糾紛所產生之損失，亦無重大未決勞資爭議個案，故無須揭露相關估計金額與因應措施。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構：

本公司資通安全管理由資訊部統籌負責，訂定資訊安全相關內部規範與制度，規劃及執行資訊安全作業，並推動資訊安全政策之落實，依據法令規範及營運需求適時檢討與更新。

公司每年由內部稽核單位執行資訊安全相關查核作業，以評估資訊作業內部控制設計及執行之有效性，作為持續改善資訊安全管理的依據。

2. 資訊安全政策：

本公司訂定「資訊安全管理政策」，其重點如下：

(1) 目的：為強化資訊安全管理，確保本公司各項資訊資產之機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）及可用性（Availability），提供穩定、安全之資訊環境，以支援公司業務持續運作，並符合法令規範及內外部利害關係人之要求，降低因內、外部刻意或意外威脅所造成之風險。

(2) 目標：確保本公司資訊作業得以正確、完整且持續運作，維持關鍵資訊系統之高可用性。

確保公司重要資訊之機密性與存取安全，透過適當之存取權限控管機制，使資訊僅得經授權人員依職務需求使用，避免未經授權之存取或濫用情形。

(3) 法規遵循：遵循國內外與資訊安全、個人資料保護及相關領域之法令、規範與契約約定，並定期檢視制度與實務作法是否符合最新法規及主管機關要求。

3. 具體管理方案：

(1) 人員教育與宣導：新進同仁須參與資訊安全教育訓練，以建立基本資安認知與防護觀念；在職員工亦透過定期宣導及課程，持續強化資安意識與遵循行為。

(2) 安全的資訊系統環境：建置安全、穩定之資訊系統與網路環境，採用適當之權限控管、身分認證及系統防護機制，以支持公司業務永續經營。

(3) 關鍵系統備援與監控：重要資訊系統或設備建置適當之備援、備份與監控機制，並定期進行演練與復原測試，以確保在突發事故或異常事件發生時，仍可維持合理之服務可用性。

(4) 終端設備管理：同仁個人電腦均需安裝合法授權之防毒軟體並定期更新病毒碼，禁止安裝或使用未經授權之軟體，以降低惡意程式入侵及版權風險。

(5) 帳號與密碼管理：同仁對其個人帳號、密碼及所屬系統權限負有妥善保管責

任，應定期變更密碼，並不得出借或轉讓予他人使用，以防止未授權存取。

- (6) 資安事件通報與應變：建立資訊安全事件通報及應變程序，明確規範通報流程、責任分工與處理時限，於發生資安異常或事件時得以即時反應、控制影響範圍、進行調查與後續改善，避免損害擴大。
- (7) 資安風險評估與稽核：公司每年定期執行資訊安全風險評估及資訊安全稽核，檢視資安控制措施之適切性與有效性，並依評估結果研擬改善計畫。綜合現階段風險評估結果，資安風險尚未達公司重大營運風險之等級，故目前暫無投保資安保險之需求，惟將持續滾動檢討。

4. 投入資通安全管理之資源：

(1) 管理系統與外部評核：

本公司已通過ISO 27001 資訊安全管理系統認證，114年度持續完成ISO 27001 續評作業，並接受外部專業機構（如會計師資訊稽核）之審查，以確認資訊安全管理制度運作情形。

公司亦定期檢視員工資訊使用行為及相關內部規範是否符合營運環境與科技發展變化，並視需求適時修訂制度。

(2) 技術防護與演練：

為防範外部資安威脅，本公司建置多元資訊安全防護系統（如防火牆、入侵偵測／防禦、郵件與網頁過濾等），以提升整體資訊環境安全性。

114年度完成製造網路隔離（MFG Network Isolation）、802.1x NPS 認證之無線網路安全機制導入，以及社交工程演練，透過實際演練檢驗員工對釣魚郵件及社交工程風險之警覺度，強化人員面對資安威脅之防護能力。

(3) 人才培育與專業訓練：

本公司每年規劃資訊安全教育訓練課程，提升全體員工資安意識與基本防護能力。

114年度除針對資訊安全專責人員辦理合計 14 小時之專業訓練課程，內容涵蓋最新資安威脅趨勢、相關法規要求及技術管控措施，以精進其專業能力並支撐資安管理持續優化外，亦針對全體員工辦理共計 163 人次、合計 489 小時之資訊安全通識教育訓練，藉此深化全員資安意識，落實「人人有責」之資訊安全文化。

- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司未發生重大資通安全事件，故無因資通安全事件所遭受之重大損失或對營運及財務產生重大不利影響之情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
抵押借款	國泰世華銀行	112/12/19~117/12/19	土地及建物為抵押品辦理融資	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、合併財務狀況分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差異	
			增(減)金額	變動比率(%)
流動資產	1,183,170	1,168,067	15,103	1.29
不動產、廠房及設備	417,122	412,369	4,753	1.15
其他資產	50,839	58,990	(8,151)	(13.82)
資產總額	1,651,131	1,639,426	11,705	0.71
流動負債	436,065	282,801	153,264	54.19
長期借款	172,672	185,543	(12,871)	(6.94)
其他負債	7,755	11,272	(3,517)	(31.20)
負債總額	616,492	479,616	136,876	28.54
股本	790,523	790,523	0	0
資本公積	98,490	98,490	0	0
保留盈餘	150,388	274,020	(123,632)	(45.12)
其他權益	(4,762)	(3,223)	(1,539)	(47.75)
股東權益總額	1,034,639	1,159,810	(125,171)	(10.79)
重大變動項目說明(前後期變動達 20%以上，且及變動金額達新台幣一千萬元者)： <ol style="list-style-type: none"> 1. 流動負債增加：主要係短期借款及應付帳款較去年同期增加所致。 2. 負債總額增加：主要係短期借款及應付帳款較去年同期增加所致。 3. 保留盈餘減少：主係 114 年度為稅前虧損所致。 				

二、合併財務績效分析

(一)經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差異	
			增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	459,861	667,587	(207,726)	(31.12)
營業成本	274,152	350,186	(76,034)	(21.71)
營業毛利	185,709	317,401	(131,692)	(41.49)
營業費用	275,669	291,926	(16,257)	(5.57)
營業淨利(損)	(89,960)	25,475	(115,435)	(453.13)
營業外收入及支出	5,399	28,971	(23,572)	(81.36)
稅前淨利(損)	(84,561)	54,446	(139,007)	(255.31)
所得稅(利益)費用	(262)	(46)	(216)	(469.57)
本期淨利(損)	(84,299)	54,492	(138,791)	(254.70)
其他綜合損益	(1,346)	2,581	(3,927)	(152.15)
本期綜合損益總額	(85,645)	57,073	(142,718)	(250.06)

增減變動比例達 20%以上，且增減變動金額達新台幣一千萬元者之分析說明：

1. 營業收入、營業成本及營業毛利減少：主係 114 年度訂單減少所致。
2. 營業淨損：主係 114 年度營業收入減少所致。
3. 營業外收支減少：主要係因 114 年度台幣升值致匯兌利益減少所致。
4. 稅前淨損、本年度淨損及本期綜合損益總額減少：主係 114 年度營業收入減少所致。
5. 對未來財務業務之可能影響：無重大影響。
6. 未來因應計劃：不適用。

(二)預期銷售數量及其依據

銷售數量係依據本公司年度銷售目標、市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形等因素，並參酌本公司產能規模而合理編製而成，預估本公司業績將呈穩定成長趨勢，可對財務業務狀況帶來正面助益。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	變動金額	變動率%
營業活動之淨現金流(出)入		23,352	126,559	(103,207)	(81.55)
投資活動之淨現金流(出)入		(114,662)	(461,684)	347,022	75.16
籌資活動之淨現金流(出)入		45,430	(74,084)	119,514	161.32

前後期增減變動率達 20%以上之變動分析說明：

1. 營業活動之淨現金流入減少：主要係因 114 年度收入較去年同期減少。
2. 投資活動之淨現金流出減少：主要係因 114 年度按攤銷後成本衡量之金融資產較去年同期減少所致。
3. 籌資活動之淨現金流入增加：主要係因短期借款增加所致。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自營 業活動淨現金流 出量(2)	預計全年投資、 籌資現金淨流入 量(3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
151,561	250,316	(100,341)	301,536	-	-

1. 未來一年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：主要係預期未來一年業務持續成長、營收獲利穩定，帶動相關營業現金流入所致。
- (2) 投資、籌資活動：主要係因購置固定資產及無形資產、償還銀行借款。

2. 預計未來現金流量現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

(二)預期可能產生效益：不適用。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

單位：新台幣仟元

項目	說明	原始投資金額	投資政策	本期認列投資損益	獲利或虧損主要原因	改善計劃	未來年度投資計劃
鑫豪科技(股)公司		13,000	接近市場	(761)	受景氣循環波動影響	加強營運管理	無
德泰半導體(股)公司		101,471	接近市場	帳面價值為零	受景氣循環波動影響	不適用	無
晶隼科技(股)公司		41,975	接近市場	帳面價值為零	受景氣循環波動影響	不適用	無
台新 1699 貨幣市場基金		10,000	增加資金收益	159	收益受交易市場影響	不適用	無
Favite Limited		61,470	投資晶隼彩光電科技(上海)有限公司	(12,109)	主要係認列晶隼彩光電科技(上海)有限公司之投資收益	不適用	配合營運規模評估增加投資之必要性、策略性投資
晶隼彩光電科技(上海)有限公司		61,470	接近市場	(12,109)	目前僅從事軟體設計研發	不適用	

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動

單位：新台幣仟元；%

項目/年度	114 年度	113 年度
利息收入(支出)淨額(A)	6,081	4,838
營業收入(B)	459,861	667,587
營業利益(C)	(89,960)	25,475
佔營業收入比例(A/B)%	1.32	0.72
佔營業利益比例(A/C)%	(6.76)	18.99

本公司將基於穩健保守之財務管理原則，與往來銀行維持密切聯繫，以即時掌握利率變動之相關訊息，降低利率波動對本公司之影響。

2. 匯率變動

本公司外銷產品係以美元報價，而向國外採購之原料主要亦以美元支付，故可藉由經常性之進銷貨相互沖抵，使部分匯率變動產生自動避險之效果，故匯率變動對營收及獲利應不致產生重大之影響。為加強匯率波動風險之管理，已採取下列具體措施：

A. 利用自然避險之特性，將銷售產品產生之外幣應收款項用來支應因採購所產生之外幣應付款項，故僅需針對外幣部分進行評估，加以分析匯率走勢，選擇有利時機結匯或清償外幣貸款，並適時操作金融工具，以規避匯率之風險。

- B. 財務人員隨時留意國際金融狀況，蒐集有關匯率變化資訊，並與銀行匯兌人員保持密切聯繫及參閱銀行及投資機構提供之金融財經資訊，以即時掌握匯率動態。
- C. 業務人員報價及議價過程中，亦衡量匯率變動調整產品價格，以適度反應匯率之波動。

3. 通貨膨脹

(1) 對公司損益之影響

若通貨膨脹仍無法控制，美國聯準會可能採取緊縮貨幣政策，導致利率上揚，將使本公司金融債務之利息支出增加。反之本公司之現金及約當現金之利息收益將增加。

(2) 未來因應之措施

本公司密切注意相關經濟環境變化及市場情勢變動，以避免遭受通貨膨脹對本公司損益之不利影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法，以適用於本公司之遵循依據。截至年報刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證交易之情事。

(三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用

本公司 115 年預計再投入新台幣 3 仟萬元，惟將視全球市場狀況及公司實際營運情形適時規劃調整。本公司未來研發計劃摘要如下：

計畫名稱	計畫說明
高精度量測設備	可對應先進封裝 Die location 量測。
AI 智能分類及 AI 智能檢測方案	AI 智能分類可搭載在晶彩不同的檢測設備上進行缺陷即時分類及篩選濾除。 AI 智能檢測可依客戶需求，搭載於機台。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，並諮詢相關專業人士，以充份掌握並因應市場環境變化，並適時調整本公司相關營運策略。截至年報刊印日止，本公司並無受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司為國內平面顯示器產業少數垂直整合檢測量測及修補設備之供應商，所生產之產品除已取得多項專利保障外，並獲得國內外面板大廠之高度評價與認同，足見本公司之研發與因應技術與產業變化之能力，未來本公司仍將持續增加研發投入外，並密切掌握市場之趨勢與脈動，以順應相關產業之演變與變化。另有關於本公司之資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等，可參考本年第 76~77 頁有關資通安全管理之說明。綜上所述，科技改變與產業變化對本公司財務業務尚不致產生重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，即致力於維持企業形象，並恪遵各項法令規定，截至年報刊印日止，並未有發生因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中風險

本公司之主要供應商皆屬長期配合之廠商，且雙方均維持良好穩定的合作關係；本公司為分散供貨集中問題，均維持二家(含)以上的供貨來源，以確保供貨穩定性。

2. 銷貨集中風險

(1) 風險

- a. 客戶依賴度高：若某一客戶佔銷售額比例過高，該客戶的需求變動或財務狀況可能會對公司營收造成重大影響。
- b. 市場波動：集中銷售於特定市場可能會使公司更容易受到該市場的經濟波動影響。
- c. 競爭壓力：若主要銷售集中於某一產品或服務，競爭者的進入或市場需求的變化可能會對公司造成壓力。

(2) 因應措施

- a. 擴展客戶基礎：增加傳統面板/新型顯示器/半導體客戶數量和多樣性，減少對單一客戶的依賴。
- b. 市場多元化：除了台灣及中國大陸之外，開始佈局拓展不同地區和市場，分散風險。
- c. 產品多樣化：本公司主要營業收入來自自動光學檢測設備產品之銷售，本公司近年積極轉戰半導體先進封裝、Micro LED 及 Micro OLED 等產業用生產設備領域，逐步實現自動光學檢量測設備在光電、電子、半導體產業的完整布局，分散產品結構，以擴展不同產品別客戶及訂單避免產品集中之市場風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要訴訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

本公司在 114 年未有任何已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

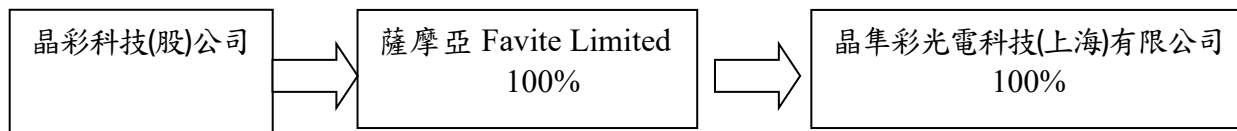
七、其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖



2. 關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目

114年12月31日 單位:新台幣仟元

企業名稱	設立時間	所在地點	實收資本	主要營業項目
Favite Limited	100年5月	薩摩亞	61,470	控股公司
晶隼彩光電科技(上海)有限公司	101年3月	上海市	61,470	軟體設計

3. 依公司法 369-3 推定為有控制與從屬關係者：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：參閱前述之 2.各關係企業基本資料。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其持股情形如下：

114年12月31日 單位：仟股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數	
			股數(股)	持股比率
Favite Limited	董事	晶彩科技股份有限公司 (法人代表人：陳永華)	2,000,000	100%
晶隼彩光電科技(上海)有限公司	董事	Favite Limited (法定代表人：胡毓麟)	—	100%

6. 各關係企業營運概況：

114年12月31日 單位:新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外)

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)
Favite Limited	61,470	25,474	-	25,474	-	-	(12,109)	(6.05)
晶隼彩光電科技(上海)有限公司	61,470	36,412	10,999	25,413	44,026	(12,046)	(12,109)	不適用

(二)關係企業合併財務報表：請參閱第 86 頁。

本公司民國 114 年度(自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係企業關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

關係企業合併財務報告聲明書

本公司 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：晶彩科技股份有限公司



負責人：陳 永 華



中 華 民 國 115 年 3 月 6 日

晶彩科技股份有限公司



董事長：陳永華

